

股票代碼：6640



均華精密工業股份有限公司
Gallant Micro. Machining Co., Ltd.

一百一十三年度年報
Annual Report 2024

本公司年報查詢網址

1、公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

2、均華網站：<http://www.gmmcorp.com.tw>

刊印日期：中華民國一百一十四年三月三十一日

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

	發言人	代理發言人
姓名	石敦智	何雅雯
職稱	總經理	財會主管
電話	(02)2268-2216	(02)2268-2216
電子郵件信箱	investor@gmmcorp.com.tw	investor@gmmcorp.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

單位	地址	電話
總公司及土城廠	新北市土城區民生街 2-1 號	(02)2268-2216
台元廠	新竹縣竹北市台元一街 8 號	(03)560-1222
蘇州廠	中國蘇州市吳中區木瀆鎮金橋開發區寶帶西路 5011 號	86-512-66366699

三、辦理股票過戶機構

名稱：凱基證券股份有限公司

地址：台北市重慶南路 1 段 2 號 5 樓

網址：<https://www.kgi.com>

電話：(02)2389-2999

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

會計師姓名：吳偉豪、江采燕會計師

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

網址：<https://www.pwc.tw>

電話：(02)2729666

五、海外有價證券相關資訊：無

六、本公司網址：<http://www.gmmcorp.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
一、113 年度營業報告	1
二、114 年度營業計畫概要	2
三、未來公司發展策略	3
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響	3
貳、公司治理報告	5
一、董事、監察人及總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
三、公司治理運作情形	16
四、簽證會計師公費資訊	41
五、更換會計師資訊	41
六、最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之公司董事長、 總經理、負責財務或會計事務之經理人	42
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	42
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係之資訊	43
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	44
參、募資情形	45
一、資本及股份	45
二、公司債辦理情形	48
三、特別股辦理情形	48
四、海外存託憑證辦理情形	48
五、員工認股權憑證辦理情形	49
六、限制員工權利新股辦理情形	51
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	51
八、資金運用計畫執行情形應記載下列事項	51
肆、營運概況	52
一、業務內容	52
二、市場及產銷概況	64
三、從業員工	69
四、環保支出資訊	70

五、勞資關係	70
六、資通安全管理	73
七、重要契約	75
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	76
一、財務狀況	76
二、財務績效	76
三、現金流量	77
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	77
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	77
六、風險管理分析評估事項	78
七、其他重要事項	80
陸、特別記載事項	81
一、關係企業相關資料	81
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	86
三、其他必要補充說明事項	86
柒、重大影響事項	86

壹、致股東報告書

一、113 年度營業報告

各位股東女士、先生大家好：

首先感謝各位股東對均華的支持，在此向各位股東報告 113 年度營業狀況

(一)營業成果：

項目	113 年	112 年	增(減)比例%
營業收入淨額	2,441,879	1,187,852	105.57
營業毛利	923,509	411,409	124.47
營業費用	481,719	292,573	64.65
營業利益	441,790	118,836	271.76
營業外收(支)	78,545	(486)	162.62
稅後淨利	412,822	101,173	308.04
歸屬於母公司淨利	412,772	100,857	309.26

(二)財務收支及獲利能力的概況

1. 財務結構

股東權益與資產比率 = 44.58%

負債與資產比率 = 55.42%

2. 償債能力

流動比率 = 141.66%

速動比率 = 93.77%

3. 獲利能力

資產報酬率 = 11.80%

股東權益報酬率(ROE) = 27.31%

純益率 = 16.90%

每股盈餘(EPS) = 14.62

本年度已新開發完成新產品(技術)

研發項目 (處理技術)	研發機台名稱
	1. Wafer & Reel to Wafer & Reel Inspection Sorter (晶圓與捲帶至晶圓與捲帶多功能檢查挑檢機)
	2. Wafer PBI System (晶圓黏晶檢查機)
	3. Wafer Sorter (晶圓多型式拆併機)
	4. Wafer to Tray Cassette Sorter (晶圓到晶粒盤盒挑揀機)
	5. High Throughput and High Accuracy Fully Automatic Fan-Out Die Bonder (高產出扇型封裝高精度大尺寸晶粒黏晶機)
	6. High Throughput and High Accuracy Fully Automatic Flip Chip Die Bonder (高產出高精度覆晶黏晶機)

	7. IGBT LEADFRAME AUTO STAMPING System (IGBT 框架自動裁切設備)
	8. Larger Panel Roate Tester (大轉盤四分度硬板電性測試設備)

二、114 年度營業計劃概要

(一) 經營方針

1、營業方面

- (1)配合先進封裝發展趨勢，持續與一線大廠配合發展國產化設備。
- (2)以精密取放之核心技術，強化發展半導體主製程設備，佈局先進封裝與記憶體應用以及測試應用領域等新市場。
- (3)整合雷射與光電視覺技術，發展高附加價值之應用。
- (4)整合精密取放與視覺處理技術，掌握智慧型手機和人工智慧零件生產專用製程設備。

2、研發方面

114 年度計畫開發之新產品(服務)

研發項目 (處理技術)	研 發 機 台 名 稱
	1. Multiple Tape Reel Unloader Module (多捲帶收料模組)
	2. Wafer ID/Reference Marking System for OHT (晶圓刻印設備)
	3. Die Bonder with Laser Assisted (晶片雷射接合機)
	4. Panel Level Face Down Die Bonder (面板級面朝下黏晶機)
	5. High Accuracy & Cleanliness Chip Sorter 高精度&高潔淨晶片挑檢機
	6. Hybrid Die Bonder (3D IC 黏晶機)
	7. High Accuracy Larger Panel O/S Tester for 64K (大尺寸板高精度 64K 電性測試設備)
	8. High Accuracy Automatic Tester for IC Carrier (高精度 IC 載板電性測試設備)

(二) 114 年度預期銷售數量及其依據

單位：套

主要產品	銷售量
	114 年預算
IC 封裝製程設備	247
IC 模具	34

註：依據客戶對未來之預估及綜合市場情況做成預期資料。

(三) 重要之產銷政策：

基於核心技術，聚焦主製程設備的發展，建立公司長期成長的發展模式。包括

- (1)以核心技術與一線大廠合作，配合其新製程之需求，提供更完整的製程設備。
- (2)統合 G2C 資源，擴增半導體產業市場的主力產品，研發技術互補，提高總體生產能量，以因應大廠的需求，提昇總體營運績效。
- (3)調整產能佈局，加強台灣研發能量以及大陸廠成本控管，以因應市場需求，並開拓海外新市場。
- (4)發展先進封裝關鍵主製程設備，擴大長期發展潛力。
- (5)應用核心技術，切入電動車、元宇宙等新市場。
- (6)結合協力廠商，強化開發能力，並提高量產能力與能量。

三、未來公司發展策略

持續根深台灣，不斷創新以提高產值為核心發展主軸，掌握半導體先進封裝發展趨勢，發展精密取放核心應用技術及具規模需求量的主製程設備，建立長期營運成長的基礎。

統合 G2C 資源，研發技術互補，提供更完整的技術整合配套方案，提高總體生產能量，以因應半導體大廠的需求。全力掌握台灣半導體先進封裝成長的大趨勢，大幅擴大營運規模，並擴大業務推廣渠道，維持在大中華地區在 IC 封裝產業設備的領導品牌，更進一步擴展到東南亞，日韓乃至於歐美等國際市場。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境及總體經營環境：

隨著美中科技戰持續升溫，台灣 AI 產業供應鏈面臨新的挑戰與機遇。這些外部壓力促使台灣企業積極調整其全球生產佈局，通過擴大國際合作來強化產業韌性。同時，生成式 AI 技術的發展也進一步提升了台灣在全球供應鏈中的地位，推動企業從傳統晶圓代工向 AI 代工（AI Foundry）轉型，形成一個更具競爭力的產業生態系。

全球半導體產業的未來走向也受到各國政策的深遠影響。美國晶片法案、歐盟晶片法案，及台灣和日本等產業發展計劃，正在重塑全球半導體供應鏈的生態系。儘管客戶對於台廠產能無法再完全集中於台灣，台灣作為全球半導體先進製程與研發紮根的核心重鎮，將在政策支持和技術創新下，繼續扮演關鍵角色。

台灣 AI 產業憑藉其在半導體製造、伺服器生產等領域的優勢，已在全球 AI 產業鏈中確立了重要地位。通過持續創新與轉型升級，台灣不僅能維持其競爭優勢，更有望成為全球 AI 產業發展的重要推手，在技術進步與社會價值之間達致平衡。

如何提高自身外部競爭能力可由幾處著手:1.技術外流與人才流失，台灣應建立嚴格的

技術出口管制機制，確保核心技術始終掌握在本土手中。2.營運成本與市場份額變動，台灣企業應加速技術創新，以提高產品附加價值，降低單純成本競爭的風險。3.多元市場與供應鏈分散化，可積極尋求與日本、韓國、歐洲等國家建立技術合作與市場聯盟，從而分散風險、擴大國際影響力。

(二) 法規環境：

誠信為本公司核心文化，故經營向以遵行法律規範、誠信守紀為基本前提。除隨時收集外部法規變動資訊提供管理階層參考，並即時建置、檢討、更新或調整內部管理、運作規章制度，以積極因應各類法規環境之變化。

(三) 總體經營環境：

本公司經營以半導體產業為主，其半導體市場為全球消費市場之聯動關係，預計半導體市場在車用電子、智慧手機、CIS、SIP、高速運算與人工智慧 5G 乃至於元宇宙等多重動能驅動之下，加上台灣大廠持續加大投資，新製程發展及量產擴產，是設備投資的引爆點，但隨著 IC 未來將以新穎多變的樣貌出現。設備商面對著不斷衍生的新機會，同時也面臨不進步將被淘汰的嚴厲挑戰，持續性的研發求變成為永續生存成長的必然。

受惠於通膨降溫，加上整體就業市場穩定，消費力回升，以及產業面的庫存調整大致完成，再加上 AI 帶動對半導體需求增加，「全年發展持樂觀看待。」

未來值得注意的兩大關鍵議題。首先，AI 發展將從雲端走向終端，生成式 AI 風潮將逐步落地至更多終端裝置的應用，除了帶動新一波 AI 伺服器的需求，AI PC 與 AI 手機也將成為終端消費市場成長的新動力，亦為生成式 AI 普及的關鍵應用。

第二，除了半導體製程持續微縮，高階封裝技術也是未來大廠的布局方向。基於成本、效能和微型化等考量因素，業界發展出多種封裝技術，除了 2.5D、3D 等 IC 封裝技術外，也驅動扇外型封裝延伸至面板級載體。臺灣半導體產業應把握這兩大機會，提前布局相關技術與產品，持續鞏固護國群山的優勢。

均華發展自有核心技術，成功置入供應鏈，由志聖、均豪、均華等大廠組成的「G2C 聯盟」，近年受惠台積電加速擴大 CoWoS 產能下，在先進封裝領域大有斬獲，半導體營收快速拉升，帶動 2024 年業績顯著成長。均華布局超過 10 年的先進封裝營收佔半導體營收的 60~90%，並透過擴大與台積電及全球前十大 OSAT（半導體封裝測試）廠的合作密度，進一步擴展其在半導體市場的全面布局。未來均華將配合主要客戶持續發展高階製程設備，擴大核心技術及產業應用領域，以最貼近客戶的快速應變，維持長期夥伴合作關係，充分掌握產業脈動、運用資源、創造獲利，為客戶、股東及員工創造最大的價值及多贏模式。

最後 敬祝各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

董事長：



總經理：



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料：

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長暨執行長	中華民國	梁文文	男 41~50歲	112/6/21	3年	106/7/24	283,000	1.00	283,000	1.01	—	—	—	—	政大企家班 第40屆 美國華盛頓州立大學商學碩士 MBA 畢 美國西北大學法律碩士畢業 美國西北大學商學學程結業 均豪精密工業(股)公司 董事長、董事 志聖工業(股)公司 顧問、董事長 均豪精密工業(股)公司 董事長特助 華聖智能科技(股)公司 董事長 長	均豪精密工業(股)公司 董事長暨執行長 志聖工業(股)公司 總經理 均豪精密工業(股)公司 副董事長暨執行長 台灣電路板協會 理事 廣信創業投資(股)公司 監察人 祁昌(股)公司 董事 創峰光電科技(股)公司 董事長 薩摩亞商力永企業有限公司 董事長 蘇州創峰光電科技有限公司 董事長	—	—	—	註 1
董事	中華民國	簡木發 代表：均豪精密工業股份有限公司	男 51~60歲	112/6/21	3年	109/6/23	— 16,171,750	— 57.19	22,000 16,342,750	0.08 58.29	— —	— —	— —	— —	中央大學機械研究所碩士 均豪精密工業(股)公司 協理	均豪精密工業(股)公司 資深協理	—	—	—	—

持股基準日 114 年 3 月 30 日；單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	陳榮亮	男 61~70歲	112/6/21	3年	102/6/20	272,000	0.96	272,000	0.97	83,000	0.30	—	—	新興工商職業學校機工科畢業 均豪精密(股)公司 模具廠課長 均強機械(蘇州)有限公司 廠長、副總、總經理 均華精密工業(股)公司 董事長、總經理 蘇州均華機械_董事長、總經理 亞毅精密(股)公司 董事長	蘇州均華精密機械有限公司 董事長 King Mechatronics Co., Ltd. 董事	—	—	—	—
董事	中華民國	石敦智	男 51~60歲	112/6/21	3年	112/6/21	395,000	1.40	221,000	0.79	36,000	0.13	205,000	0.73	國立成功大學機械工程所碩士 均華精密工業(股)公司 總經理 祁昌股份有限公司 董事	均華精密工業(股)公司 總經理	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	陳正	男 71~80歲	112/6/21	3年	106/7/24	—	—	—	—	—	—	—	—	慶應義塾大學工學博士畢業 工研院機械所副所長 旺矽科技(股)公司 副董事長 日神精密(股)公司 董事長 易發精密(股)公司 獨立董事	盟英科技(股)公司 監察人 美商日紳台灣分公司 榮譽董事長 盟立自動化(股)公司 薪資報酬委員會委員	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	施森豪	男 71~80歲	112/6/21	3年	106/7/24	—	—	—	—	—	—	—	—	日本早稻田大學經濟學系學士畢業 日本宮城縣光仁醫院 事務長	森德貿易(股)公司 顧問	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	陳君宇	男 51~60歲	112/6/21	3年	112/6/21	—	—	—	—	—	—	—	—	中國復旦大學比較法學碩士畢業 信邦電子(股)公司 副總經理 旺旺集團(中國上海) 行政處長 大陸通商專業法律事務所 經理	無。	—	—	—	—

註1：本公司董事長及執行長為同一人主要為提昇經營效率與決策執行力，增進股東利益、以達企業永續經營的目標願景，董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人，以保有客觀性及監督的力量。

(二) 法人股東之主要股東

113 年 6 月 22 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
均豪精密工業股份有限公司	志聖工業股份有限公司(27.10%)
	兆銀託管日商麥克尼克司株式會社投資專戶(1.64%)
	均豪精密工業股份有限公司庫藏股專戶(1.01%)
	陳政興(0.48%)
	花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶(0.46%)
	邱慶亮(0.42%)
	兆豐國際商業銀行股份有限公司(0.41%)
	匯豐銀行託管美林國際公司投資專戶(0.41%)
	匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶(0.35%)
	陳志強(0.3%)

註：均豪精密工業股份有限公司最近一次停過日為 113 年 6 月 22 日。

(三) 主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 29 日

法人名稱	法人之主要股東
志聖工業股份有限公司	均豪精密工業股份有限公司(12.73%)、海杏投資股份有限公司 代表人：陳梁金絨(11.31%)、品志投資股份有限公司 代表人：梁碧茹(7.85%)、梁茂忠(4.65%)、志聖工業股份有限公司庫藏股專戶(3.82%)、梁茂生(2.92%)、花旗託管挪威中央銀行投資專戶(2.34%)、簡進土(1.79%)、朕昇股份有限公司(1.23%)、梁又文(1.23%)、渣打託管 SPDR 組合新興市場 ETF 專戶(1.03%)

註：志聖工業股份有限公司最近一次停過日為 114 年 3 月 29 日。

(四) 董事及獨立董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
梁又文 董事長		具備商務、財務或公司業務所 須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事	不適用	無
簡木發 董事 代表：均豪精密工業 股份有限公司				無
陳榮亮 董事				無
石敦智 董事				無
陳正 獨立董事			1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或 其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名 義)未有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發 行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條 第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱 人。 4.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法 務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
施森豪 獨立董事				無
陳君宇 獨立董事				無

(五) 董事會多元化及獨立性：

1、董事會多元化：

本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選舉辦法」明確規定董事選任資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。明訂董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- (1) 營運判斷能力。
- (2) 會計及財務分析能力。
- (3) 經營管理能力。
- (4) 危機處理能力。
- (5) 產業知識。
- (6) 國際市場觀。
- (7) 領導能力。
- (8) 決策能力。

本公司多元化目標如下：

- (1) 獨立董事席次不低於三分之一。
- (2) 獨立董事連續任期不超過三屆。

本公司第六屆董事會共七位成員，獨立董事席次占所有董事比率 43%，各具備商務、法務、財務、會計或公司業務等專業領域，年齡分佈於 41~80 歲，為強化公司治理，擬於 114 年補選一名獨立董事，獨立董事席次占比將提升至 50%；為配合董事多元化政策，擬於下一屆董事會增加不同性別董事。

董事會成員多元化情形政策落實情形

職稱	董事長	董事			獨立董事		
姓名	梁 又 文	簡 木 發	陳 榮 亮	石 敦 智	陳 正	施 森 豪	陳 君 宇
性別	男	男	男	男	男	男	男
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	41-50	51-60	61-70	51-60	71-80	71-80	51-60
兼任本公司員工	✓			✓			
獨立董事連續任期	不適用	不適用	不適用	不適用	第三任	第三任	第一任
專業背景							
法律	✓						✓
產業	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
行銷或科技	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
專業技能與產業經歷							
營運判斷	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
會計及財務	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

經營管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
危機處理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
國際市場關	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
領導決策	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2、董事會獨立性：

本公司全體董事會成員七人，包含三位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次 43%；114 年股東常會全體董事席次將調整為八人，包含四位獨立董事，預計獨立董事人數佔全體董事席次 50%。全體董事成員間並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

(六) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

持股基準日 114 年 3 月 30 日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	石敦智	男	110.11.03	221,000	0.79	36,000	0.13	205,000	0.73	國立成功大學機械工程所碩士畢 工研院半導體設備發展部 黏晶機 計劃主持人(國防役) 華東半導體(股)公司 研發部副理 均豪精密工業(股)公司 研發處處長 均華精密工業(股)公司 副總經理 祁昌股份有限公司 董事	—	—	—	—	—
協理	中華民國	黃良印	男	109.08.12	150,000	0.54	—	—	—	—	國立成功大學機械工程所碩士畢 華東半導體(股)公司 研發部副理 均豪精密工業(股)公司 設計中心& 雷射應用事業處 研發單位副處長	—	—	—	—	—
協理	中華民國	林坤輝	男	112.08.01	65,000	0.23	—	—	—	—	東南技術學院機械系	樂林科技股份有限公司 董事	—	—	—	—
財會主管	中華民國	何雅雯	女	102.3.18	—	—	—	—	—	—	台北商業技術學院會計統計二專畢 寶晨會計師事務所 領組 均豪精密工業(股)公司 專員	祁昌股份有限公司 監察人	—	—	—	—

二、董事、總經理及副總經理之酬金

(一) 最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金：

1-1 一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名方式及酬金方式)

單位:新台幣仟元；%

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取自子公司以外轉置董事或公司酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司		現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司
董事長	梁又文	-	-	-	-	2,484	2,484	54	54	2,538 0.62%	2,538 0.62%	3,908	3,908	-	-	500	-	6,946 1.68%	6,947 1.68%	36
董事	簡木發 代表：均豪精密工業股份有限公司	-	-	-	-	2,485	2,485	54	54	2,539 0.62%	2,539 0.62%	-	-	-	-	-	-	2,539 0.62%	2,539 0.62%	-
董事	陳榮亮	-	-	-	-	2,484	2,484	48	48	2,532 0.61%	2,532 0.61%	-	-	-	-	-	-	2,532 0.61%	5,540 1.34%	-
董事	石敦智	-	-	-	-	2,484	2,484	54	54	2,538 0.62%	2,538 0.62%	22,380	22,380	108	108	2,000	-	27,026 6.55%	27,026 6.55%	4,922
獨立董事	陳正	192	192	-	-	2,485	2,485	96	96	2,773 0.67%	2,773 0.67%	-	-	-	-	-	-	2,773 0.67%	2,773 0.67%	-
獨立董事	施森豪	192	192	-	-	2,485	2,485	96	96	2,773 0.67%	2,773 0.67%	-	-	-	-	-	-	2,773 0.67%	2,773 0.67%	-
獨立董事	陳君宇	192	192	-	-	2,485	2,485	102	102	2,779 0.67%	2,779 0.67%	-	-	-	-	-	-	2,779 0.67%	2,779 0.67%	-

1.請敘明一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(1)依本公司公司章程規定，本公司董事長、董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準授權由董事會議定之；公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 3%作為董事酬勞。

(2)依本公司薪資報酬委員會組織規程之規定，訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於說明合理性。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0 仟元。

1-2 酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名				
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)		
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	母公司及所有轉投資事業	
低於 1,000,000 元	簡木發	簡木發	簡木發	簡木發	
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—	—	—	
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	陳榮亮、梁又文、均豪精密工業股份有限公司、石敦智、施森豪、陳正、陳君宇	陳榮亮、梁又文、均豪精密工業股份有限公司、石敦智、施森豪、陳正、陳君宇	陳榮亮、均豪精密工業股份有限公司、施森豪、陳正、陳君宇	均豪精密工業股份有限公司、施森豪、陳正、陳君宇	
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	—	—	
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—	梁又文	陳榮亮、梁又文	
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	—	—	
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—	—	
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	石敦智	石敦智	
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	—	
100,000,000 元以上	—	—	—	—	
總計	8(內含法人 1 位)	8(內含法人 1 位)	8(內含法人 1 位)	8(內含法人 1 位)	

2-1、總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
執行長	梁又文	2,248	2,248	-	-	1,660	1,660	500	-	500	-	4,408 1.07%	4,408 1.07%	36
總經理	石敦智	2,404	2,404	108	108	19,976	19,976	2,000	-	2,000	-	24,488 5.9%	24,488 5.9%	4,922

2-2 酬金級距表

	給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		總經理及副總經理姓名	
	本公司	母公司及所有轉投資事業	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	-	-	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	梁又文	梁又文	梁又文	梁又文
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	石敦智	石敦智	石敦智	石敦智
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	2 人	2 人	2 人	2 人

3、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新臺幣仟元；%

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	梁又文	—	4,620	4,620	1.12
	總經理	石敦智				
	協理	黃良印				
	協理	林坤輝				
	財會主管	何雅雯				

(二) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1、最近二年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例：

單位：新臺幣仟元；%

酬金給付對象		112 年度		113 年度	
		酬金總額	占稅後純益比例(%)	酬金總額	占稅後純益比例(%)
本公司	董事	4,645	4.60	18,472	4.48
	總經理及副總經理	9,946	9.86	28,896	7.00
合併報表所有公司	董事	4,665	4.62	18,472	4.48
	總經理及副總經理	9,946	9.86	28,896	7.00

2、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 本公司董事酬金，依本公司章程第二十二條規定，本公司董事長、董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻，並參酌國內外業界水準授權由董事會議定之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第二十六條規定以當年度獲利狀況不低於百分之一且不高於百分之十五分派員工酬勞及不高於百分之三分派董事酬勞。
- (2) 本公司董事酬金，依「薪資報酬委員會組織規程」與「董事會績效評估辦法」作為評核之依循。其績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量績效評估結果與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營情況、未來風險及相關法令適時檢討酬金制度、標準與結構，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
- (3) 本公司支付予執行長、總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞金及中長期留才獎勵措施等。其中，薪資之議定係由薪資報酬委員會參酌其所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司營運目標之貢獻度，並參考公司年度經營績效、未來風險、及同業水準審議合理薪資。獎金與酬勞主要連結經理人之績效評估項目，包含財務指標(如獲利

能力、營業利益及年度策略達成率等)，並隨時視實際經營狀況、未來風險及相關法令適時檢討酬金制度。本公司經理人酬金經薪資報酬委員會審議後，提報董事會決議。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形資訊：

1.最近年度董事會開會 8 次(A)，董事與獨立董事出(列)席情況如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	梁又文	8	0	100%	-
董事	簡木發 代表：均豪精密工業(股)公司	8	0	100%	-
董事	陳榮亮	8	0	100%	-
董事	石敦智	8	0	100%	-
獨立董事	陳正	8	0	100%	-
獨立董事	施森豪	8	0	100%	-
獨立董事	陳君宇	8	0	100%	-

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱本年報第 18 頁審計委員會運作情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決議事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

日期	董事姓名	議案內容	應迴避利益原因	參與表決情形	決議情形
113.01.17	梁又文 石敦智	本公司 112 年經理人年終獎金分配案	與董事自身有利害關係	不參與表決	其餘五席董事無異議一致通過
113.02.21	梁又文 石敦智	112 年度員工與董事酬勞總數案 本公司經理人及董事之競業許可案	與董事自身有利害關係	不參與表決	其餘五席董事無異議一致通過
113.08.06	梁又文 石敦智	本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案 本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案 本公司 113 年經理人調薪案	與董事自身有利害關係	不參與表決	其餘五席董事無異議一致通過
113.12.19	梁又文 石敦智	本公司 113 年經理人年終獎金分配案	與董事自身有利害關係	不參與表決	其餘五席董事無異議一致通過

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，本公司董事會評鑑執行情形如下表 2。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」規定，訂定本公司「董事會議事規範」等管理辦法供遵行外，設有獨立董事制度，使公司董事會結構更趨於完整，並依相關法律及主管機關之函釋規定進行運作，以達兼備執行與監督雙重績效。

(一)董事會結構

本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事長與總經理非由同一人兼任，董事及獨立董事皆屬單獨之個體，獨立行使其應有職權，另有關董事持股比、股份轉讓之限制及質權之設定等亦充分揭露於公開資訊觀測站中，以供投資大眾查詢。

(二)獨立董事制度

本公司目前設有獨立董事三席，並依證券交易法等規定賦予充分參與決策及表示意見之權力。為保障投資人權益，本公司章程明文規定依據公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，持有一定股數以上股東之獨立董事提名權及相關程序，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，受理作業公正透明。

(三)審計委員會之設置

本公司審計委員係由獨立董事三席擔任，「審計委員會組織規程」明定審計委員會獨立行使職責之權能，以確實監督公司內部控制之有效實施與財務報表之編製。

(四)薪資報酬委員會之設置

本公司依證券交易法第 14 條之 6 規定，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並完成薪資報酬委員會之委員聘任及設置，以協助董事會執行其職務。

(五)提升資訊透明度

本公司財務資訊、重大議事決議、董事出席董事會情形、董事參加進修課程等資訊均已依相關法令規定公佈於公開資訊觀測站，本公司之財務業務資訊亦揭露於公司網站上，投資大眾均可及時獲得資訊。

2.董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年 1 月 ~113 年 12 月	董事會績效評估、 個別董事成員績效 評估、審計委員會 績效評估、薪資報 酬委員會績效評估	董事自評	董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制 個別董事成員績效評估：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制 審計委員會績效評估：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、內部控制 薪資報酬委員會績效評估：對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任

本公司已完成 113 年度董事會及功能性委員會內部績效自評，評估結果並提送 114 年 2 月 20 日董事會報告，做為檢討及改進之依據。各項範圍評估結果如下，顯示整體董事會運作良好。

範圍	綜合評分(滿分 5 分)
董事會績效評估	4.98
個別董事成員績效評估	4.99
審計委員會績效評估	5.00
薪資報酬委員會績效評估	5.00

(二) 審計委員會運作情形資訊：

最近年度審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)【B/A】	備註
獨立董事	陳正	6	0	100%	-
獨立董事	施森豪	6	0	100%	-
獨立董事	陳君宇	6	0	100%	-

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會 召開日期/期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目 內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.02.21 第三屆 第六次	1.通過 112 年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2.通過 112 年度內部控制制度有效性考及聲明書 3.通過 112 年度營業報告書 4.通過 112 年度盈餘分派議案 5.通過資本公積分配現金股利案 6.發行限制員工權利新股與員工案 7.通過同意本公司經理人及董事之競業許可案	無	同意	照案通過
113.05.07 第三屆 第七次	1.通過 113 年第 1 季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2.通過本公司對轉投資公司提供背書保證案 3.通過本公司對轉投資公司資金貸與案	無	同意	照案通過
113.05.29 第三屆 第八次	1.同意購置不動產交易案	無	同意	照案通過
113.08.06 第三屆 第九次	1.通過 113 年第 2 季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項	無	同意	照案通過
113.11.01 第三屆 第十次	1.通過 113 年第 3 季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2.通過本公司 114 年年度稽核計畫 3.通過本公司對轉投資公司提供背書保證案 4.通過本公司「董事會議事規範」修正案 5.通過本公司「董事會績效評估辦法」修正案 6.通過本公司「審計委員會組織規程」修正案	無	同意	照案通過

	7.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案 8.通過本公司「關係人相互間財務業務管理辦法」修正案 9.通過 113 年第一次買回本公司股份案			
113.12.19 第三屆 第十一次	1.通過現任會計師獨立性及適任性評估案 2.通過本公司「融資循環」修正案 3.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 4.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」訂定案 5.通過本公司「永續資訊管理辦法」訂定案 6.通過本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」訂定案 7.通過本公司「風險管理政策與程序」訂定案 8.通過本公司「113 年第一次買回股份轉讓員工辦法」修正案	無	同意	照案通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：獨立董事透過定期核閱稽核報告、審查財務營運表冊，並於每季董事會或必要時就公司財務、業務狀況與稽核主管及會計師進行溝通。

四、年度工作重點：

- (1)依據年度稽核計畫定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
- (2)審閱財務報告。
- (3)考核內部控制制度之有效性。
- (4)簽證會計師獨立性評估。
- (5)法規遵循。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要情形	
公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實守則？		√		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於本公司網站-投資人專區(http://www.gmmcorp.com.tw)	無重大差異情形
公司股權結構及股東權益	公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並依規定建立發言人制度由股務單位及股務代理機構處理相關事宜並於公司網站揭示聯絡窗口。	無重大差異情形
	公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		本公司每月依規定公告內部人持股情形，並隨時了解其異動情形，以掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無重大差異情形
	公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		本公司訂有「關係人交易作業程序」、「對子公司經營管理之監理作業辦法」等內部控制辦法，建立與關係企業之風險控管及防火牆機制，每年稽核單位依稽核計畫查核其執行情形。	無重大差異情形
	公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		本公司已訂立「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，每年視需要辦理宣導課程。	無重大差異情形
董事會之組成及職責	董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		本公司訂有「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求已擬定適當之多元化方針，其整體應具備之能力如下一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。」，本公司董事會成員已符合規定，各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。相關具體管理目標及落實情形請參閱本年報第9頁董事會多元化及獨立性。	無重大差異情形
	公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		√	本公司之章程中，未明訂設置各類功能性委員會，惟已依法令規定設置審計委員會及薪資報酬委員會。其他功能性委員會未來將視需要評估設置。	無重大差異情形

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要情形	
董事會之組成及職責	公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		本公司業已於109年12月23日經審計委員會審議並送交董事會討論通過後訂定「董事會績效評估辦法」，明訂本公司董事會及功能性委員會每年執行一次內部績效評估。評估程序應於次一年度第一季結束前完成，並將評估結果報告董事會，且運用於提名續任之參考。本公司已於113年12月完成董事會及功能性委員會內部績效評估並於114年2月20日董事會報告。	無重大差異情形
	公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		本公司已訂定「簽證會計師選任審查辦法」，每年由審計委員會及董事會評核現任會計師之獨立性及適任性；於審查會計師前，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依標準與13項AQI指標進行評估。經確認簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近3年也將持續導入數位審計工作，提高審計品質。另函請本公司股務代理機構確認其持股情形，經本公司財會單位審查確認符合獨立性及適任性後，送請審計委員會進行審議，提報董事會決議；民國113年度會計師審查評核表業已於民國113年12月19日提報審計委員會及董事會通過。本公司評估會計師獨立性要件審查、運作及適任性檢查重要標準項目列舉如下： ›會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。 ›會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。 ›會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 ›會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。 ›會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 ›會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件	無重大差異情形

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要情形	
				有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。 >會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。 >會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性。	
上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?		√		本公司之公司治理主管係由財務暨會計主管兼任，提供董事與獨立董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄。 本公司訂有「處理董事要求之標準作業程序」，協助董事遵循相關法令及回應董事問題。	無重大差異情形
公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?		√		(一)本公司於公司網站(http://www.gmmcorp.com.tw)設置利害關係人專區，並於公司網站上依不同利害關係人(員工、客戶、供應商、投資人)揭露列述其溝通管道。 (二)本公司設有各種溝通會議，鼓勵員工與管理階層進行意見交流，並於本公司網站之人力資源專區建置員工專屬信箱，讓員工得以透過電子郵件即時反映意見及提供建言，冀與員工保持密切互動。	無重大差異情形
公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?		√		本公司已委任專業股務代辦機構-凱基證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異情形
資訊公開	公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	√		本公司已架設公司網站(http://www.gmmcorp.com.tw)，定期揭露及更新公司財務業務及公司治理相關資訊。	無重大差異情形
資訊公開	公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)	√		本公司設有專人負責資訊蒐集，並依規定即時允當揭露相關資訊。且本公司已依規定設置發言人與代理發言人制度，並於公司網站(http://www.gmmcorp.com.tw)揭露其姓名與聯絡方式。	無重大差異情形

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要情形	
	公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		本公司依相關規定，於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。	無重大差異情形
	公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	√		本公司管理階層積極推動公司治理，相關採行之制度與措施及履行情形摘要如下： (一)本公司訂有相關人事規章辦法與獎勵制度，重視員工權益，積極扶助員工自治組織之健全並協助其員工活動之舉辦，另採購、廠務、財務之運作訂有嚴格控管制度，對供應廠之遴選、相關業務之輪調與職務代理人制度，皆有明確之規範。本公司於公司網站建置員工意見信箱 HR@gmmcorp.com.tw，期許員工與公司直接進行溝通。 (二)投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利：力求公司資訊透明化，依法令規定即時允當揭露各項財務業務資訊，並設置連絡窗口及電子信箱，以提供投資人、供應商及利害關係人留言及意見反應之管道。為加強公司治理，除例行之財務業務資訊公開揭露外，公司網站架設公司治理專區，提供投資者更多元化的資訊，以保障國內外投資者之權益。 (三)董事進修之情形：本公司全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定進修相關課程，已依規定於公開資訊觀測站公告。 (四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業經營，配合相關法令規定，推動及落實各項政策之執行。有關公司營運重大政策、投資案、取得或處分資產、背書保證等事項皆經相關權責部門評	無重大差異情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要情形	
			估分析後，交送董事會決議執行。稽核單位依風險評估結果擬定年度稽核計畫並確實執行，以落實風險控管等監督機制。 (五)客戶政策之執行情形：本公司因應客製化之需求，提供良好的服務及解決客戶之問題，並由業務部定期或不定期拜訪客戶，提供客戶雙向溝通之各種管道。 (六)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，並於公開資訊觀測站上公告。	
請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：無。				

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1、薪資報酬委員會成員資料

持股基準日：114 年 3 月 30 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	施森豪	具備商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事		1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
獨立董事	陳正				1
獨立董事	陳君宇				無

2、薪資報酬委員會職責

- (1)定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估、年度及長期績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：112 年 6 月 30 日至 115 年 6 月 29 日，最近年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註 1)	備註
召集人	施森豪	4	0	100%	-
委員	陳正	4	0	100%	-
委員	陳君宇	4	0	100%	-

註 1：本公司 113 年共召開 4 次薪資報酬委員會，出席狀況如下表：

開會日期／出席董事	施森豪	陳正	陳君宇
113.01.17(三)	V	V	V
113.02.21(三)	V	V	V
113.08.06(三)	V	V	V
113.12.19(四)	V	V	V

薪資報酬委員會日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.01.17	1.本公司 112 年度員工與董事酬勞分配案。	同意	照案通過
113.02.21	1.112 年度員工與董事酬勞總數案。	同意	照案通過
113.08.06	1.本公司 112 年度董事酬勞分配案。 2.本公司 112 年度經理人酬勞分配案。 3.本公司 113 年經理人調薪案。	同意	照案通過
113.12.19	1.母公司庫藏股轉讓本公司經理人案。 2.本公司 113 年度經理人年終獎金分配案。	同意	照案通過

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		√	本公司由總經理擔任主席帶領經營團隊所組成之永續經營委員會為推動永續發展之權責單位。 「永續經營委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。該委員會下分別設置產品/客戶關懷委員會、公司治理委員會、員工關懷委員會、環安衛委員會及永續供應鏈委員會，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 「永續經營委員會」每年至少需向董事會報告永續發展推動情形一次，113年度執行情形已於113年12月19日董事會進行報告，議案內容包含： (1)智慧財產管理計畫及執行情形 (2)誠信經營執行情形 (3)企業社會責任 (4)資訊安全 (5)利害關係人溝通情形	無重大差異情形

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	
公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？			√	本公司設置「永續經營委員會」做為推動企業永續專職單位，其風險評估邊界新北土城廠、新竹台元廠及高雄辦公室之據點，考量營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，尚未將子公司納入範疇。 永續經營委員會依循永續報告書之重大性原則進行分析，與利害關係人溝通與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題，並採用問卷方式整合各部門資訊，據以評估重大性之ESG議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策，並提出改善措施。於本公司113年永續報告書揭露董事會對永續發展之管理方針及策略目標督導情形。 無重大差異情形
環境議題	公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？		√	本公司依照生產作業之各項特性，訂有標準作業程序及標準書，除要求人員確實依照公司規範執行工程作業，更致力於加強作業環境、活動、儀器或設備之安全衛生風險控制。 無重大差異情形
	公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？		√	本公司持續致力於提升各項資源之利用效率，例如減少紙張使用，內部公文以傳閱方式代替複印；文書用紙儘量雙面使用；影印機旁設置資源回收架，回收紙張再利用；並鼓勵員工自行攜帶杯具、便當盒及環保筷，儘量減少使用紙杯、紙餐盒；信封、牛皮紙袋重複使用，並作為內部公文傳遞袋。 無重大差異情形
	公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？		√	面對氣候變遷，本公司積極推動與改革溫室氣體減量管理措施，包含節能效率提升方案，如： 1. 更換節能燈管(LED燈)。 2. 視情況更換節能之空壓機。 無重大差異情形

推動項目		執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
		是	否	摘要說明																	
	公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		本公司於113年起接受ISO14064-1：2018溫室氣體盤查之輔導，預計115年全面導入ISO14064-1：2018溫室氣體盤查並通過外部查證，其中土城廠區業於114年3月7日通過外部查證，其餘廠區預計115年通過外部查證，後續將於每年進行溫室氣體盤查，並針對盤查結果進行檢討及改善。 <table><tr><th>項目</th><th>112 年</th><th>113 年</th><th>單位</th></tr><tr><td>溫室氣體排放量</td><td>註</td><td>868.2570</td><td>公噸 CO2e</td></tr><tr><td>總用水量</td><td>3,388.3900</td><td>3,740.6045</td><td>m³</td></tr><tr><td>一般廢棄物</td><td>45.8550</td><td>42.4200</td><td>公噸 (MT)</td></tr></table> 註：尚未進行溫室氣體盤查。	項目	112 年	113 年	單位	溫室氣體排放量	註	868.2570	公噸 CO2e	總用水量	3,388.3900	3,740.6045	m ³	一般廢棄物	45.8550	42.4200	公噸 (MT)	無重大差異情形
項目	112 年	113 年	單位																		
溫室氣體排放量	註	868.2570	公噸 CO2e																		
總用水量	3,388.3900	3,740.6045	m ³																		
一般廢棄物	45.8550	42.4200	公噸 (MT)																		
社會議題	公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√		本公司皆確實遵守相關勞動法規並尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及履行公平無差別待遇之雇用政策，並已制訂適當之管理制度，以監督管理。	無重大差異情形																

推動項目		執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明	
社會議題	公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√		本公司內部規範有「薪資作業管理辦法」、「績效考核管理辦法」等提供員工合理薪資報酬政策，並建立明確有效的獎勵及懲戒。 <u>員工薪酬</u> 秉持照顧員工，提供完善的獎酬結構外，並將員工績效考核制度與企業社會政策結合，將誠信經營納入員工教育訓練、績效考核與人力資源政策中。員工酬勞則係依本公司章程規定，於本公司當年度獲利不低於1%且不高於15%計算之。 <u>員工福利措施</u> 設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項。請參閱第70頁-勞資關係-員工福利措施 <u>職場多元化與平等</u> 本公司致力於提供員工工具尊嚴、安全的工作環境，我們落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。113年度女性員工占比為23%、女性主管占比為37%。 <u>經營績效反映於員工薪酬</u> 本公司每年均參與市場薪酬調查，依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。	無重大差異情形

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	
	公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√		<u>安全與健康之工作環境</u> 於辦公室設有中央空調系統、充足的照明設備，舒適合宜的視覺及聽覺工作空間，設置緊急逃生路線及出口，定期進行電梯設備保養，備有消防設施並定期舉行消防演練、定期消毒清潔工作環境及進行水質檢測，並實施門禁管制。其他有關員工人身安全之保護措施則悉依勞動相關法規及公司內部各項福利保障措施辦理。 <u>定期實施安全與健康教育</u> 定期舉行消防演練、安排員工受訓一般勞工安全衛生教育訓練及各項事故防範教育。 113年職業安全衛生教育訓練共67人次受訓，共201小時、試車安全、事故防範教育及安全風檢點辨識控制等課程共360人次受訓，共360小時。 在公司提供之健康工作環境下未發生任何員工職災之案件；113年度職災案件數0位，火災之件數0件，故無任何死傷之人數。

無重大差異情形

推動項目		執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明	
	公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		公司十分重視員工的職能發展，由主管與員工每半年定期檢視在該職位上所需具備能力之職能提升規劃，並視員工之需求，公司會根據工作需求全額補助相關課程費用，安排員工參加外部專業培訓。 針對訓練範疇區分為新進人員、專業訓練及員工在職訓練等項，在新人協助方案方面，由新進人員與主管和資深員工共同擬定「新進人員訓練計劃」，協助新進人員盡早熟悉工作內容與環境。公司透過「員工成長規劃」引導並計劃出員工的成長規劃，描繪願景，找到方向，讓員工可以在公司的平台上有所發展，主管和資深員工與員工討論在公司的短、中、長期目標，並根據不同階段指派合適的指導教練，針對所需的職能進行持續培訓和指導，確保員工在不同階段能夠有效成長。此成長規劃將於每半年度績效考核時與指導教練進行面談檢視與調整。 113年度各式職涯訓練共計582人次，總時數約2,151小時。 全公司各部門，都有配合工作內容參與內部或外部進修以提升專業職能，113員工培訓發展執行狀況請參閱本年報第71頁-勞資關係-員工進修及訓練情形。	無重大差異情形
	針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		本公司與廠商和客戶間均保持良好溝通管道，並對研發、採購、生產、作業及服務提供透明且有效之客訴抱怨處理程序。	無重大差異情形
	公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		本公司目前對供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政策。	無重大差異情形

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		√	無。	無重大差異情形
公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				

其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

- (一)本公司遵循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並確認其人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。
- (二)本公司對於危害勞工權益之情事，提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴予以妥適之回應。
- (三)本公司應提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律及其所享有之權利。
- (四)本公司承諾從過去、現在到未來，均將遵守商業道德規範，並致力於下述事項：
 - 1.恪遵法律規範，維持良好的公司治理，嚴守商業道德規範，包含廉潔經營，無不正當收益等事項。
 - 2.禁止使用童工及不當歧視。
 - 3.對員工定期實施安全與健康教育訓練，提供員工合理的報酬與福利及安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上之災害。
 - 4.提供客戶優質且安全的設備與服務。
 - 5.尊重並保護智慧財產權。
- (五)本公司應建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。
- (六)本公司為員工職涯發展創造良好環境，訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），建立有效之職涯能力發展培訓計畫。
- (七)本公司對產品與服務負責並重視行銷倫理。其研發、採購、生產、作業及服務流程，應確保產品及服務資訊之透明性及安全性，設置售後服務，並依政府法規與產業之相關規範，不得有欺騙、誤導、詐欺之行為，並宜評估管理可能造成營運中斷之各種風險，降低對客戶與社會造成之衝擊。
- (八)本公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。
- (九)社會共榮
 - 1.公益關懷
 - *捐助「愛無國界關懷協會」，加入資助西非布吉納貧童教育計畫，關懷弱勢兒的「愛霖新種子贊助計畫」，認養二名孩童，共投入 36,000 元。
 - *支持「ESG 世界公民數位治理基金會-百萬學童-世界公民素養教育計畫」透過推動世界公民理念、K12 學童的素養教育，加強台灣人從自我連結到世界公民的認同感。共投入新台幣 8 萬元。
 - *贊助「中平國小棒球隊」，推動品格棒球，培養台灣球壇後進新秀，每年贊助 20 萬元。
 - *支持文化平權，贊助「躍演劇團」《勸世三姊妹》庄頭版，透過生動的音樂和舞蹈，觀眾不僅能欣賞到本土傳統習俗的魅力，還能感受到現代人對傳統文化的反思與重新詮釋，為台灣這片土地寫下動人的篇章，贊助劇團 310 萬元。
 - 2.產學合作
 - *加入 GOLF 學用接軌聯盟，透過雲端學習平台，啟動實習培訓推動，藉由線上專業課程先修、線下企業實習參訪，以產學合作方式促進學生提早與產業接軌，共投入新台幣 5 萬元。
 - *為鼓勵國內頂尖教授持續精進學術，捐助臺灣大學工學院「學術勵進獎」，選出 10 位教授提供優渥獎金 30 萬元。及提供「優秀僑生獎學金」，獎勵台灣大學成績優秀之僑生，培育傑出人才暨未來回饋鄉里，捐助新台幣 60 萬元。
 - *為強化延攬及留任國內外頂尖人才，捐助工學院「學術勵進青年講座」，同時也建立起新進教師與企業研發的連結，化解大學的人才危機，捐助新台幣 30 萬元。
 - *參與國研院儀科中心舉辦之「國研盃 i-ONE 儀器科技創新獎」競賽，推動自製儀器觀念，培育基礎科學研究人才，鼓勵青年學子將創意實現，蘊育出許多優秀的儀器自製人才，贊助活動獎金 5 萬元。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
*參與成功大學專題實作獎，透過贊助專題實作獎金 2 萬元鼓勵參賽學生動手製作機器人，將理論轉化為實務，培養創新與技術能力，激發對機器人技術的興趣，培育未來科技人才。 3.社區發展 *均華的新竹廠區是很重要的研發中心，因為地緣關係與新竹在地的國立清華大學有著緊密的產學合作，透過公司提供業界及目前合作專案的資訊，讓學生可以從理論中有更有實務經驗的學習，共計有 4 項合作案，有 13 位同學參與計畫案，計劃總經費為 453 萬元。 *與 G2C+聯盟共同辦理清華大學 DIT Robotics 機器人暑期營隊，透過舉辦科技主題的夏令營，可以吸引有興趣的同仁子女，將他們培養成企業未來需求的人才，共花費約 12 萬元；同時為了鼓舞這些優秀學子，更贊助清華學子出國競賽經費 30 萬元。				

(六)氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所	1. 董事會為本公司氣候治理之最高單位，負責推動與監督氣候相關議題策略方向，不定期討論當前氣候風險機會趨勢，並針對關鍵氣候風險決策具體策略、目標，以穩定維持公司之永續經營。董事會轄下設立永續經營委員會由總經理擔任主席，每年至少 1 次向董事會呈報公司永續推動進程與執行成效。 2. 依評估結果，本公司鑑別出利害關係人及客戶對環保/低碳要求提升、以低碳商品替代現有產品和服務、極端氣候事件嚴重性和頻率增加及開發/增加低碳產品或服務為本公司當前關鍵氣候風險與機會議題。評估如下表 1 所示 3. 上述已辨識出之氣候變遷風險與機會，已綜合考量氣候風險與機會發生之可能性及時間、對公司之影響程度等因子，逐一分析對公司潛在之營運與財務衝擊，其財務衝擊影響請詳上第 2 點之說明。 4. 本公司依循 TCFD 框架制定氣候相關風險鑑別與管理程序。為使本公司掌握當前關鍵氣候機會與風險，永續經營委員會每年定期蒐集同業之永續報告書、CDP 氣候問卷及國際趨勢之風險機會議題，先行收斂本公司攸關之潛在氣候議題後，再向各相關部門單位蒐整年度因應氣候風險情況，並透過訪談各氣候議題相關單位對議題之衝擊程度與發生可能性看法，鑑別出本公司關鍵重大氣候風險與機會，並將結果向上提報董事會，由董事會進行決議與訂定集團策略。

抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1 及 1-2)。	

表一

風險/ 機會	風險/機會說明	期程	潛在財務影響	因應策略與管理措施
轉型 風險	宣導環保節能措施	短期 (3 年內)	成本增加	強化員工教育訓練，提供激勵措施，提高參與度
	客戶及利害關係人對環保／低碳要求提升	中期 (3-10 年)	營運成本增加、 營收減少	1. ISO 14064-1 溫室氣體盤查 2. 導入能源管理系統 (ISO 50001) 3. 智慧電表與 LED 燈更換 4. 導入產品碳足跡 5. 研發節能產品與流程優化
	以低碳商品替代現有產品與服務	中期 (3-10 年)	生產成本及研發支出增加、 營收減少	1. 市場調查與趨勢分析 2. 製程技術優化 3. 產學合作 4. 提供已售產品之節能改造服務
實體 風險	極端氣候事件嚴重性和頻率增加	短期 (3 年內)	營業成本增加 營業收入減少	1. 供應鏈風險評估與多元化 2. 應急小組與應變措施 3. 備用工作地點設置與測試
機會	開發/增加低碳產品或服務	中期 (3-10 年內)	營業收入增加	1. 減碳研發專案 2. 產學合作 3. 智慧節能設備推廣 4. 產品節能改造服務 5. 年度市場調查 6. 啟動研發項目 7. 技術優化與供應鏈低碳溝通

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

本公司自 113 年起導入國際標準組織(ISO)發布之 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查標準建立相關機制，並擬於 114 年完成本公司個體之溫室氣體排放量，並取得第三方確信。本公司最近兩年度之溫室氣體排放量、密集度即資料涵蓋範圍，請詳下表：

	112 年度	113 年度
範疇一排放量(公噸 CO ₂ e)	註	49.8292
範疇二排放量(公噸 CO ₂ e)	註	410.1800
總計	註	460.0092

營業額(新台幣百萬元)	864	2,061
密集度(公噸 CO2e/百萬元)	註	0.22
資料涵蓋範圍	註	均華個體公司(100%)

註：本公司於 113 年始導入 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查標準建立相關機制，故無 112 年資訊。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

完整資訊將揭露於永續報告書，並於次一年度年報揭露資訊。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

完整資訊將揭露於永續報告書，並於次一年度年報揭露資訊。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目		運 作 情 形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
		是	否	
訂定誠信經營政策及方案	公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		無重大差異情形
	公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√		無重大差異情形
	公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		無重大差異情形

評估項目		運 作 情 形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
		是	否		摘要說明
落實誠信經營	公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√		公司不與有不誠信行為紀錄者進行交易，且在契約中明訂雙方權利義務。	無重大差異情形
	公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√		本公司已於113年成立永續發展委員會，並在該委員會下成立「公司治理委員會」，每年定期向董事會報告執行情形。113年度執行情形已於12月19日向董事會報告。 委員會建立企業誠信與倫理規範，維持清廉秩序，落實營運及財務管理，維護公司利益，保障股東權益，恪守商業行為及道德準則規範，使公司穩健成長。	無重大差異情形
	公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√		本公司對內相關內部規章與員工公司工作守則均公布於公司內部網站，並於修訂時函知全體同仁。對外於公司網站設置利害關係人專區。	無重大差異情形
落實誠信經營	公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√		本公司已訂有內部控制制度、內部稽核實施細則、會計制度及各項管理規章，且運作情形正常並落實誠信經營之要求，本公司內部稽核依稽核計畫進行查核並製成稽核報告，定期於董事會報告稽核結果。	無重大差異情形
	公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		本公司定期辦理與誠信經營相關之教育訓練，於113年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會、勞動爭議防免及公司治理、營業秘密、法律實務課程等課程)，共計409人次，合計472.5小時。 並已將相關規範之作業程序及辦法置於本公司內部網站，以供員工隨時查閱。	無重大差異情形

評估項目		運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明	
公司檢舉制度之運作情形	公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		公司設有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，管理單位為稽核室，並設有檢舉信箱： investor@gmmcorp.com.tw	無重大差異情形
	公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」已訂有保密機制，如處理檢舉案之相關人員，必須遵守和公司簽署之保密協議。	無重大差異情形
	公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√		所有檢舉事件相關文件、證據及錄像檔案，另行保密封存，以保護檢舉人不會遭受不當之處置。	無重大差異情形
加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？		√		本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」已上傳至公開資訊觀測站，並揭露於本公司網站 (http://www.gmmcorp.com.tw)。	無重大差異情形
公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司之『誠信經營守則』係依『上市上櫃公司誠信經營守則』編制並執行，尚無重大差異。					
其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： (一)本公司遵循相關法規及內部控制制度，嚴禁不誠信或違反法令之行為，並聘請法律顧問提供諮詢。 (二)本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 (三)本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，訂立「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，本公司之董事、經理人、受僱人及其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人，應遵守本作業程序相關規定。					

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊，得一併揭露：

本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，並已於內部文件管理系統公告，供經理人及員工隨時查閱。

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

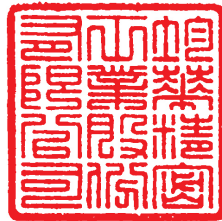
1、內部控制制度聲明書

均華精密工業股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114 年 02 月 20 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及 5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 02 月 20 日董事會通過，出席董事 7 人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。



均華精密工業股份有限公司

董事長：梁又文



簽章

總經理：石敦智



簽章

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

會議名稱	會議日期	重要決議暨執行情形
股東常會	113.6.24	重要決議 1. 112 年度營業報告書暨財務報告案 2. 112 年度盈餘分派案 3. 本公司「公司章程」修正案 4. 通過發行限制員工權利新股案 5. 同意本公司董事之競業許可 執行情形 1. 訂定 113 年 07 月 01 日為分配基準日，已依股東會決議以保留盈餘分配每股 3.5 元暨以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積發放現金每股 1.5 元，已於 113 年 07 月 10 日全數發放完畢。 2. 公司章程修訂，業經 113 年 07 月 02 日獲經濟部准予變更登記。

會議名稱	會議日期	重要決議
董事會	113/01/17	1. 通過本公司 112 年經理人年終獎金分配案
董事會	113/02/21	1. 通過 112 年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2. 通過 112 年度內部控制制度有效性考核及聲明書 3. 通過 112 年度營業報告書 4. 通過 112 年度員工與董事酬勞總數案 5. 通過 112 年度盈餘分派議案 6. 通過資本公積分配現金股利案 7. 發行限制員工權利新股予員工案 8. 通過同意本公司經理人及董事之競業許可案 9. 通過召開 113 年股東常會相關事宜與受理股東提案相關內容案
	113/05/07	1. 通過 113 年第 1 季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2. 通過本公司對轉投資公司提供背書保證案 3. 通過本公司對轉投資公司資金貸與案 4. 通過訂定本公司 112 年度現金配息基準日相關事宜
董事會	113/05/29	1. 同意購置不動產交易案
董事會	113/08/06	1. 通過 113 年第 2 季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2. 通過本公司 112 年度董事酬勞分配案 3. 通過本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案 4. 通過本公司 113 年經理人調薪案
董事會	113/11/01	1. 通過 113 年第 3 季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2. 通過本公司 114 年年度稽核計畫 3. 通過本公司對轉投資公司提供背書保證案 4. 通過本公司「董事會議事規範」修正案 5. 通過本公司「董事會績效評估辦法」修正案 6. 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案 7. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案 8. 通過本公司「關係人相互間財務業務管理辦法」修正案 9. 通過 113 年第一次買回本公司股份案
董事會	113/12/19	1. 通過本公司 113 年經理人年終獎金分配案 2. 通過本公司 114 年年度預算 3. 通過現任會計師獨立性及適任性評估案

會議名稱	會議日期	重要決議
		4.通過本公司「融資循環」修正案 5.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 6.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」訂定案 7.通過本公司「永續資訊管理辦法」訂定案 8.通過本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」訂定案 9.通過本公司「風險管理政策與程序」訂定案 10.通過本公司「113 年第一次買回股份轉讓員工辦法」修正案
董事會	114/02/20	1.通過 113 年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2.通過 113 年度內部控制制度有效性考核及聲明書 3.通過 113 年度營業報告書 4.通過本公司「公司章程」修正案 5.通過本公司基層員工定義 6.通過 113 年度員工與董事酬勞總數案 7.通過本公司 113 年度董事酬勞分配案 8.通過 113 年度盈餘分派議案 9.通過訂定本公司 114 年度現金股利配息基準日相關事宜 10.通過本公司補選獨立董事一席案 11.通過召開 114 年股東常會相關事宜與受理股東提名及提案相關內容案

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	吳偉豪	113.01.01~113.13.31	1,850	532	2,382	
	江采燕	113.01.01~113.12.31				

註 1：審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	112 年 2 月 21 日
更 換 原 因 及 說 明	本公司配合資誠會計師事務所內部輪調機制，自 112 年第一季起，本公司財務報告之簽證會計師更換為吳偉豪及江采燕會計師。

說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師	委任人
	情 況			
	主動終止委任			
	不再接受(繼續)委任		不適用	
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無。			
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務	
			財務報告之揭露	
			查核範圍或步驟	
			其 他	
	無	√		
	說明			
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無			

(二)關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	資誠聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	吳偉豪、江采燕
委 任 之 日 期	112 年 2 月 21 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度 截至 3 月 31 止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長暨執行長	梁又文	-	63,000	-	-
董事暨總經理	石敦智	-	-	(174,000)	(345,000)
董事	陳榮亮	-	-	-	-
董事代表人	簡木發	-	-	-	-
大股東暨董事所 代表之法人	均豪精密工業 股份有限公司	-	-	171,000	-
獨立董事	施森豪	-	-	-	-
獨立董事	陳正	-	-	-	-
獨立董事	陳君宇	-	-	-	-
協理	黃良印	-	-	-	-
協理	林坤輝	-	-	-	-
財會主管	何雅雯	-	-	-	-

註 1：係年報刊印日止在任者。

(二) 股權移轉資訊：

本公司董事、經理人及持股比例 10%以上股東之股權移轉，均於櫃檯買賣市場向非特定人為之，交易價格均為市價，故不適用。

(三) 股權質押資訊：上述股權質押之相對人非關係人。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股基準日 114 年 3 月 30 日；單位：股；%

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義合 計持有股份		前十大股東相互間具有關 係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者，其名稱 或姓名及關係		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
均豪精密工業股份有限公司	16,342,750	58.29	—	—	—	—	志聖工業	其董事所代表 法人	—
							梁又文	其董事	
代表人：簡木發	22,000	0.08	—	—	—	—	—	—	—
志聖工業股份有限公司	2,175,000	7.76	—	—	—	—	均豪精密	大股東	—
代表人：梁茂生	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花旗(台灣)商業銀行受託保 管挪威中央銀行—外部經理人 標線資產管理亞洲有限公司投 資專戶	541,000	1.93	—	—	—	—	—	—	—
梁又文	283,000	1.01	—	—	—	—	均豪精密	董事	—
陳榮亮	272,000	0.97	83,000	0.30	—	—	—	—	—
石敦智	221,000	0.79	36,000	0.13	205,000	0.73	智理	其代表人	—
智理股份有限公司	205,000	0.73	—	—	—	—	—	—	—

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
代表人石敦智									
品志投資股份有限公司	151,000	0.54	—	—	—	—	志聖工業	大股東	—
代表人：梁碧茹	6,000	0.02	—	—	—	—	—	—	—
黃良印	150,000	0.54	—	—	—	—	均華精密	員工	—
成美投資股份有限公司	133,000	0.47	—	—	—	—	—	—	—
代表人：張欽華	99,000	0.35	—	—	—	—	—	—	—

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

113 年 12 月 31 日；單位：股；%

轉投資事業名稱 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
KMC	2,780,645	100	-	-	2,780,645	100
GMMM	500,000	100	-	-	500,000	100
蘇州均華	不適用	100	-	-	不適用	100
祁昌	2,660,600	53.21	-	-	2,660,600	53.21
昆山祁鴻	不適用	100	-	-	不適用	100
樂林科技	500,000	25	-	-	500,000	25

註：係公司採用權益法之長期投資。

叁、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1、股本形成經過

114 年 3 月 30 日；單位：股／新臺幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
100.4	10	30,000,000	300,000,000	17,200,000	172,000,000	受讓分割淨資產發行新股 170,000,000 元	無	註 1
100.9	10	30,000,000	300,000,000	18,900,000	189,000,000	員工認股 17,000,000 元	無	註 2
100.11	10	30,000,000	300,000,000	20,005,000	200,050,000	員工認股 11,050,000 元	無	註 3
101.5	10	30,000,000	300,000,000	24,572,500	245,725,000	現金增資 45,675,000 元	無	註 4
102.9	10	30,000,000	300,000,000	24,767,500	247,675,000	員工認股 1,950,000 元	無	註 5
105.6	10	30,000,000	300,000,000	25,717,500	257,175,000	員工認股 9,500,000 元	無	註 6
107.10	10	30,000,000	300,000,000	28,276,500	282,765,000	現金增資 17,410,000 元 員工認股 8,180,000 元	無	註 7

註 1：北府經登字第 1005019092 號

註 2：北府經登字第 1005056315 號

註 3：北府經登字第 1005069186 號

註 4：北府經登字第 1015031164 號

註 5：北府經登字第 1025054829 號

註 6：新北府經司字第 1055183587 號

註 7：新北府經司字第 1078070921 號

2、股份種類

114 年 3 月 30 日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	28,276,500	1,723,500	30,000,000	流通在外股份係上櫃股票

3、總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

持股基準日 114 年 3 月 30 日；單位：股；%

主要股東名稱	持有股數(股)	持股比例(%)
均豪精密工業股份有限公司	16,342,750	58.29
志聖工業股份有限公司	2,175,000	7.76
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行－外部經理人標線資產管理亞洲有限公司投資專戶	541,000	1.93
梁又文	283,000	1.01
陳榮亮	272,000	0.97
石敦智	221,000	0.79
智理股份有限公司	205,000	0.73
品志投資股份有限公司	151,000	0.54
黃良印	150,000	0.54
成美投資股份有限公司	133,000	0.47

(三) 公司股利政策及執行狀況

1、公司章程所定之股利政策

本公司當年度決算後如有本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，依下列順序辦理之：

- (1) 彌補虧損
- (2) 列 10%法定盈餘公積，惟法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時不在此限
- (3) 依需要提列或迴轉特別盈餘公積
- (4) 如尚有餘額加計以往累積未分配盈餘後，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求、財務結構、盈餘情形及平衡穩定之股利政策，就股利分派時其中現金股利分配之比例以不低於股利總額 10%。

2、本公司章程未明訂股東股息紅利之分派比率，考量公司資金需求、長期財務規劃等因素及兼顧股東利益，本公司對股東股息紅利之提撥以不低於當年度本期稅後淨利之 20% 為基礎。

3、本次股利分派之情形

本公司於 114 年 2 月 20 日經董事會決議 113 年度盈餘分配如下：以保留盈餘分配 420,548 仟元(每股 15 元)。

4、預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無此情形。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事酬勞：

1、公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司應以當年度獲利狀況不低於 1% 且不高於 15% 分派員工酬勞及不高於 3% 分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。即扣除累積虧損後，再就餘額計算員工、董事酬勞。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2、本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司依 113 年度獲利金額估列董事及員工酬勞金額如下方說明，未以股票分派員工酬勞，若實際分派金額若與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3、董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於 114 年 2 月 20 日董事會決議提撥員工酬勞及董事酬勞如下，其與 113 年度認列費用無差異。

項目	(金額：新臺幣元)
員工酬勞	84,963,400
董監酬勞	17,392,600

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4、前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無。

項目	實際發放數	估計數	差異數
員工酬勞	14,733,700	14,733,700	0
董事酬勞	3,683,400	3,683,400	0
合計	18,417,100	18,417,100	0

(六) 公司買回本公司股份情形：

114 年 3 月 31 日

買 回 期 次	第 4 次 (期)
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	113/11/04~113/12/24
買 回 區 間 價 格	472 元至 1,325 元

已買回股份種類及數量	普通股 240,000 股
已買回股份金額	184,489,054 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	80%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	-
累積持有本公司 股份數	-
累積持有本公司 股份數量占 已發行股份總數比率(%)	-

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

員工認股權憑證辦理情形

114 年 3 月 31 日

員工認股權憑證種類	第一次發行	第二次發行
申報生效日期	112 年 9 月 15 日	
總單位數	1,500,000 單位	
發行（辦理）日期	112 年 9 月 27 日	112 年 12 月 19 日
已發行單位數	1,400,000 單位	100,000 單位
尚可發行單位數	0 單位	
發行得認購股數占已發行股份總數比率	4.95%	0.35%
認股存續期間	自被授予員工認股權憑證日起算四年	
履約方式	以本公司發行新股交付	
限制認股期間及比率（%）	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限。	
	屆滿年限	累積可行使認股權比例
	2 年	25%
	2.5 年	50%
	3 年	75%
	3.5 年	100%
已執行取得股數	0 股	0 股
已執行認股金額	0 元	0 元
未執行認股數量	1,400,000 股	100,000 單位
未執行認股者其每股認購價格	116.1 元	133.4 元
未執行認股數量占已發行股份總數比率（%）	4.95%	0.35%
對股東權益影響	對原股東權益逐年稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。	

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

[illegible]

註 1：係依截至年報刊印日止已發行股份總數 28,276,500 股計算之。

註2：以姓氏筆畫排列。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形應記載下列事項：

- (一)計畫內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容，包括歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入本會指定資訊申報網站之日期：無。
- (二)執行情形：就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫。前款之各次計畫內容如屬下列各目者，另應揭露下列事項：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1、公司所營業務主要內容：

本公司以精密取放、精密加工及光電整合之核心技術，強化發展半導體封裝主製程設備與精密模具，佈局先進封裝與記憶體應用，以及電測應用領域等新市場。發展核心及應用技術及具規模需求量的主製程設備，建立長期營運成長的基礎。

近期並統合 G2C 資源，以策略聯盟擴大業務推廣渠道，核心產品與技術互補，提高總體生產與服務的能量，以因應大廠的需求，提昇總體營運績效。掌握台灣投資成長趨勢，大幅擴大營運規模，並進軍海外市場，以成為 IC 先進封裝產業設備的領導品牌。

2、營業比重

單位：新臺幣仟元；%

主要產品	112 年度		113 年度	
	銷售金額	營業比重(%)	銷售金額	營業比重(%)
半導體製程設備及相關精密模具	1,089,370	91.71	2,294,427	93.96
其他(註)	98,482	8.29	147,452	6.04
合計	1,187,852	100.00	2,441,879	100.00

註：屬零件和技術服務收入

3、公司目前之商品(服務)項目

(1)半導體製程設備及相關精密模具

A.精密加工

- (A)沖切成型機(Trim / Form System)
- (B)自動封膠機 (Auto Molding System)
- (C)FPC Trim / Form 沖切成型機
- (D)基板沖孔成型機(Substrate Punch System IC)
- (E)自動封膠機用模具(Mold Chase)
- (F)沖切成型機用模具與精密元件(Die Set /kit)
- (G)全自動板材模壓機(Fully Auto Panel Molding System)
- (H)覆晶凸塊壓平設備(FC Bump Coin Lamination)

B.精密取放

- (A)Consumer/Driver IC 晶粒挑檢機

(B)IC 黏晶機

(C)IC 晶粒多面檢查挑檢機

(D)散熱片上蓋機

C.光電雷射

(A)雷射刻印機

(B)自動化光學檢測設備(Automated Optical Inspection Machine)

D.其他

(A)晶圓或晶粒移載等精密取放應用設備

(B)電測機

(2)其他

A.零件及技術服務

B.電子測試儀器(度量衡除外)及設備之設計製造與維護

4、計畫開發之新商品(服務)

研發項目 (處理技術)	研發機台名稱
	1. Multiple Tape Reel Unloader Module (多捲帶收料模組)
	2. Wafer ID/Reference Marking System for OHT (晶圓刻印設備)
	3. Die Bonder with Laser Assisted (晶片雷射接合機)
	4. Panel Level Face Down Die Bonder (面板級面朝下黏晶機)
	5. High Accuracy & Cleanliness Chip Sorter (高精度&高潔淨晶片挑檢機)
	6. Hybrid Die Bonder (3D IC 黏晶機)
	7. High Accuracy Larger Panel O/S Tester for 64K (大尺寸板高精度 64K 電性測試設備)
	8. High Accuracy Automatic Tester for IC Carrier (高精度 IC 載板電性測試設備)

(二) 產業概況

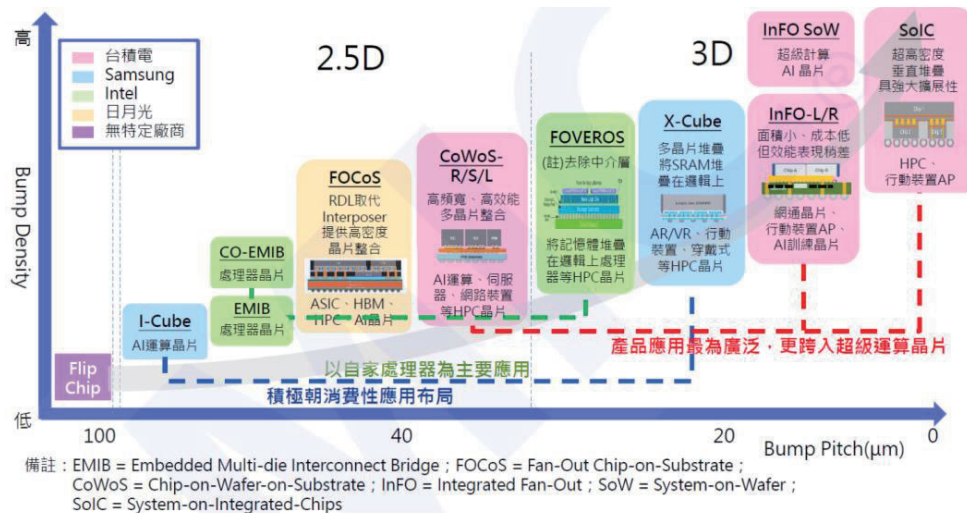
1、產業之現況與發展

(1)半導體產業

半導體產品主要包含積體電路(IC)、分離式元件/功率元件(Discretes)、感測元件(Sensors)及光學元件(Optoelectronics)等四大類。其中積體電路(IC)產業上游至下游依序可分為 IC 設計、IC 製造、IC 封裝及 IC 測試，其中 IC 製造主要以晶圓代工與記憶

體(DRAM、Flash、SRAM、ROM 等)製造為主，而 IC 封裝主要分為導線架封裝(DIP、SOP、QFP 等)、基板封裝(BGA)、軟板封裝(COF、TCP) 及先進封裝(Fan-Out、CoWoS)，台灣於在晶圓代工及封測領域之產值市占率均為全球第一，先進封裝的推展也領先全球。均華及其子公司專注於 IC 封測設備及晶片檢測設備之製造及服務之提供，主要銷售客戶為從事晶圓代工及 IC 封測與半導體廠商。

先進封裝發展趨勢



資料來源:資策會(2023/12)

A. 全球積體電路(IC)產業概況

2024 年全球半導體市場將迎來景氣復甦，市場規模達到 6,276 億美元，整體成長達 19.1%，其中記憶體市場成長最快，成長達 71.8%。通訊和運算仍是市場主導，但儲存和車用半導體市場也表現強勁，未來成長動能高於平均水準。各領域主要廠商如 Intel、NVIDIA、Qualcomm 等積極推出新技術及產品，以穩固市場地位。總體而言，半導體產業將迎來更多的機遇與挑戰，廠商需彈性及靈活應對市場變化，同時持續創新。

從產品結構看，2024 年有兩個積體電路項目出現了兩位數增長，邏輯晶片和記憶體晶片分別成長 21% 和 61.3%。同時，分立器件、光電器件、傳感器和模擬晶片出現 2%~10% 負增長。另外，2024 年 GPU、FPGA、ASIC 等邏輯晶片增速高於行業平均增速 4%，得益於 AI 大模型對底層大模型算力激增。

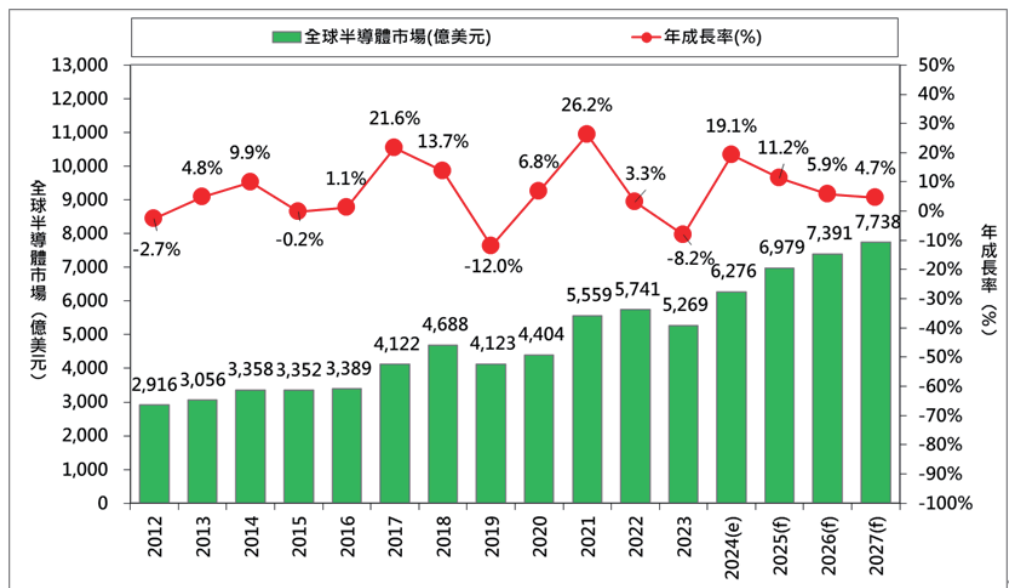
展望未來，半導體市場的成長預測 2025 年的情況可能會更好，預計銷售額將達到 6,979 億美元，成長率達 11.2%，創下歷史新高，並有望實現 2030 年晶片銷售額達到 1 兆美元的目標。這意味著該產業在 2025 年至 2030 年期間的年複合成長率為 7.5%。假設該產業繼續以該速度成長，到 2040 年其規模可能達到 2 兆美元。雖然記憶體在 2024 年成長了 71.8%，但非記憶體領域僅成長了 2.6%。AI 仍在成長，但成長會放緩，至於 AI 的 HBM 記憶體價格將趨於穩定，以及 PC 和智慧型手機甚至汽車需求都呈現疲軟狀態。

綜觀全球半導體產業發展趨勢，地緣政治局勢的加劇，如烏俄戰爭和中美貿易戰，皆導致企業風險不確定性攀升，影響整個半導體生態系。為了分散地緣政治風險，各國紛紛提高供應鏈彈性，生產基地逐漸從中國擴及東南亞、印度、美國等地，將產能遷移出中國，並且強化半導體自主供應鏈，以預防供應鏈中斷危機。此外，全球主要國家積極扶植半導體產業，祭出半導體振興政策，形塑產業發展優勢，力圖提升本土產業量能和關鍵技術自主性。

地緣政治下，半導體供應鏈韌性成為全球關注焦點，各國為提升自身半導體產業競爭力，積極推出相關政策，鼓勵半導體在地製造、強化研發能量，而這推進國際半導體大廠積極進行全球布局。

亞洲雖然作為主要半導體製造基地的地位難被取代，但各國晶片法案短期內對區域半導體布局仍具關鍵影響力。細看美、日、歐的晶片法案與半導體政策補助，主要針對當地企業以及為當地客戶提供重要服務的公司，「短期內，這些法案在推動在地產能建置方面成效顯著，但長期來看，仍須面對營運與成本挑戰和客戶需求變化，因此後續效果仍有待觀察。」

全球半導體市場需求年度預測趨勢



資料來源：WSTS (2025/02)；工研院產科國際所 (2025/02)

B. 台灣積體電路(IC)產業概況

2024 年臺灣 IC 產業正式突破 5 兆元關卡，年成長達 22.4%，高於全球市場平均水準。臺灣在全球半導體產業中占據重要地位，特別是在先進封裝領域。隨著 AI 和 HPC 需求的增長，先進封裝技術成為產業發展的關鍵。

全球半導體產業的未來走向也受到各國政策的深遠影響。美國晶片法案、歐盟晶片法案，及台灣和日本等產業發展計劃，正在重塑全球半導體供應鏈的生態系。台灣作為全球半導體製造的核心重鎮，將在政策支持 and 技術創新下，繼續扮演關鍵角色。在 AI 和高效能運算等應用需求的推動下，若從臺灣 IC 設計業、製造業、封測業等三大次產業來看，2025 年台灣 IC 產業產值將達新臺幣 6 兆元，預估年成長率為 16.2%，持續推動臺灣 IC 產業邁向新紀元。

展望 2025 年，全球暨臺灣 IC 製造產業將持續在技術革新與終端電子產品創新應用的雙重推動下，邁向新的高峰。無論是先進製程技術的競賽，還是 HBM 市場的成長，各大廠商的技術布局與資本投入，將深刻影響未來幾年的產業走勢。臺灣憑藉其先進製程技術領先的優勢，將繼續引領市場發展，並為全球半導體產業帶來更多成長機會。以下是臺灣在先進封裝領域的幾個重要發展方向。

1. 2.5D/3D IC 以 Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) 最熱門、供不應求：

台積電在先進封裝憑藉 CoWoS 技術，已從單純的晶圓代工跨足封裝領域。CoWoS 技術透過中介層整合多顆晶片於同一封裝內，提升訊號傳輸效能並降低功耗。晶片堆疊，其技術層次高、利潤也較高。另外晶片堆疊在基板上，根據排列的形式，分為 2.5D 與 3D 兩種，目前主要應用於 HBM 與 AI 運算晶片的整合。

2. 扇外型封裝朝面板級發展：

扇外型面板級封裝 (Fan-out Panel Level Packaging, FOPLP) 透過玻璃基板替代傳統圓形晶圓，可提高產能並降低成本。FOPLP 的廠商進入如群創，台積電、日月光、力成等。目前主要應用於成熟製程如車用、物聯網等。

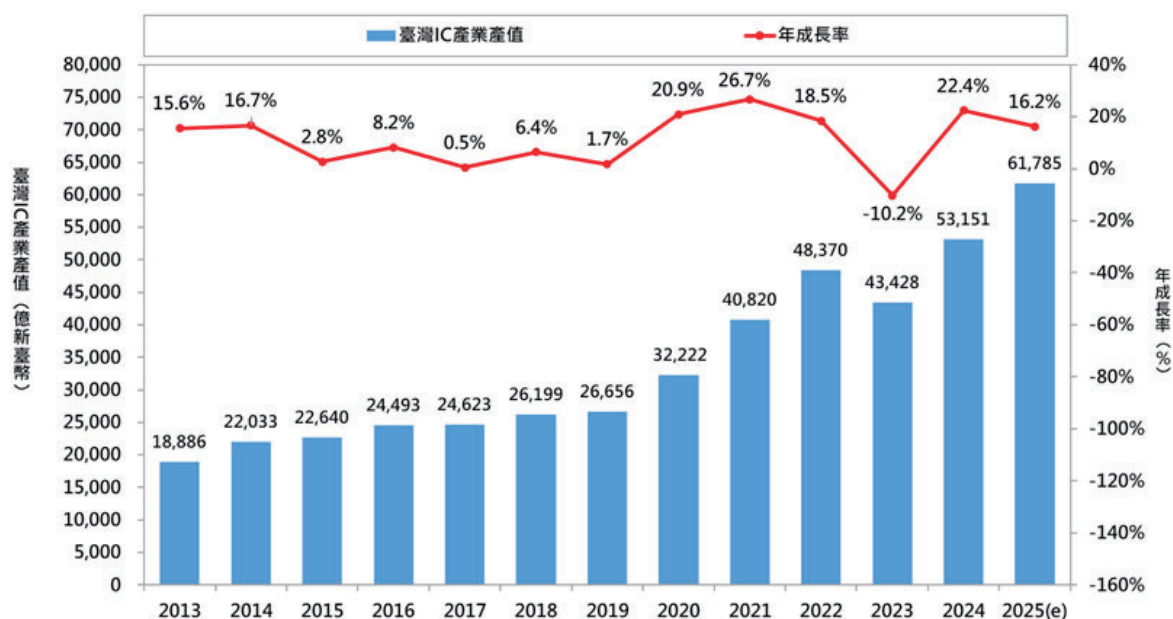
3. 異質整合與混合鍵合封裝技術：

聯電積極布局先進封裝，其技術發展聚焦於晶圓堆疊混合鍵合 (Wafer-on-Wafer Hybrid Bonding) 與 PoP (Package-on-Package) 封裝技術，以提升晶片互連密度、縮短訊號傳輸距離並提高封裝效率。此外，聯電加強 HBM 封裝整合，並推動異質整合系統級封裝 (SiP)，強化 HPC 與 AI 應用能力。

4. 先進封裝的關鍵發展：

將光電整合模組和晶片封裝在一起的技術，稱之為共同封裝光學 (CPO)，隨著生成式 AI 的浪潮，需要大量運算資源的雲端服務供應商面臨數據爆炸性成長，資料中心建置需求成為 CPO 主要驅動力，實現 CPO 的商業化應用將是未來重點方向。

臺灣 IC 產業產值年成長趨勢



資料來源：TSIA；工研院產科國際所（2025/02）

(2) 半導體設備製造業

A. 全球半導體設備產業概況

SEMI 公布整體 OEM 半導體設備報告，2024 年全球半導體製造設備銷售總額將較去年同比增長 3.0%，攀上 1,094 億美元新紀錄，成長力道也將延續至 2025 年，在前、後段製程需求共同驅動下，銷售總額可望再創歷史新高，來到 1,275 億美元。

SEMI 分析：「半導體製造設備總銷售額 2024 年的成長曲線延伸至 2025 年將進一步擴大，強勁增長約 16.5%。全球半導體產業用以支持 AI 浪潮中各式顛覆性應用的強大基礎和成長潛力現正展露無遺。」

晶圓廠設備（含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備）繼 2023 年創紀錄的 960 億美元銷售額後，2024 年上升至 2.8% 至 986 億美元，AI 運算效應發酵、中國設備支出持續走強以及對 DRAM 和高頻寬記憶體（HBM）的大量投資都是數字上修的主因。展望 2025 和 2026 年，在先進邏輯和記憶體應用需求增加帶動下，晶圓廠設備銷售額可望更上一層樓，增幅 14.0% 至 1,230 億美元。

宏觀經濟形勢後段設備歷經兩年衰退後，終於在 2024 年下半年開始回溫，其中半導體測試設備銷售 2024 年增長 13.8% 至 71 億美元，組裝和封裝設備則有 22.6% 的增幅，銷售額達 49 億美元。後端細分市場的增長加速飆升，2025 年測試設備/組裝和封裝銷售額各有 14.7% 及 16.0% 的漲幅，背後成長動能主要以日益複雜的高效能運算半導體設備，以及針對汽車、工業和消費性電子終端市場需求的預期復甦。此外，後段製程成長也將隨時序推展而增加，才能消化晶圓廠不斷往上攀升的供應量能。

2024 年晶圓代工和邏輯應用晶圓廠設備銷售額減少 2.7% 至 586 億美元，這是由於 2023 年成熟製程需求疲軟以及先進製程銷售額高於預期；受惠於先進技

術需求不斷增長、新設備架構引進以及產能擴張採購增加，預計 2025 年將出現 2.8% 的增長，來到 602 億美元。

記憶體相關資本支出在並於，2024 年 NAND 設備銷售額相對疲軟，成長 0.7% 至 93 億美元，為 2025 年呈現持續走揚一躍 47.8% 至 137 億美元的強勢漲幅奠定良好基礎。DRAM 設備銷售額則在 AI 應用元件上所需的 HBM 記憶體和持續技術遷移帶動需求激增的推波助瀾下，2024 年設備銷售額強勁增長 35.3% 達 188 億美元，隨後 2025 年將增長 10.4%。

中國、台灣和韓國至 2025 年仍將穩居設備支出前三大。中國區設備採購量雖已放緩但仍保持彈性，期間內期望維持領先地位，2024 年中國的設備出貨量創紀錄 490 億美元，鞏固其領先地位。然而相對其他地區設備支出出現 2024 年下滑，將於 2025 年開始反彈。中國在過去三年大量投資後，預計於 2025 年出現收縮。

全球半導體設備成長趨勢



資料來源：SEMI (2024/12)

B. 台灣半導體設備產業概況

針對台灣半導體先進封裝設備銷售量，2024 年成長 8.5% 以上達 1532 億台幣，2025 年有機會再成長超過 10%，主要是受惠於 AI 伺服器、車輛和物聯網等終端應用高度發展，展開多種先進封裝技術如 InFO、CoWoS、FOWLP、FOPLP、SoIC 等，帶動相關設備維持穩健的成長。

展望未來 AI 仍是唯一焦點：

2025 年 AI 仍是唯一焦點，其他消費性半導體復甦依舊緩慢，估計 PC 和智慧手機再度僅有低個位數成長，而通用型伺服器稍好有中個位數成長。從台灣上游 AI 供應鏈觀察，2025 年持續看到更積極擴產，台積電的 CoWoS 產能將全年滿載，在 NVDA、AMD 和 CSP 大客戶客制 ASIC 領攻下，預期台積電 CoWoS 供應產能年

成長 135%，加上後續產品發展佈局多晶片堆疊 SoIC 和 CPO 矽光子共同封裝將扶持本土晶圓設備廠一路成長至 2028 年。

隨 AI GPU/ASIC 晶片封裝尺寸越來越大，我們發現台積電和大客戶從 CoWoS-S 朝 CoWoS-L 擴產發展，幾年後台積電有望轉到扇外型面板級封裝解決方案，不過現階段台積電先以 CoWoS-L 擴產，2024 年 CoWoS-L 僅佔 CoWoS 總產能 5%，2025 年將大幅增加至 35%，2026 年則逼近 70%，因此未來 2 年 CoWoS-L 將蔚為主流。

先進封裝趨勢帶動本土供應商：

台積電和委外封測大廠日月光正擴大與台灣本土小型半導體設備公司合作，以往晶圓代工業者主要向歐美日大廠購買設備，業者不會更換供應商，因良率風險較高，然而進入先進封裝(例如 CoWoS-S、CoWoS-L、SoIC、CPO、FoPLP)時代，由於製程和以往大不相同，台積電和日月光需要大量新設備。

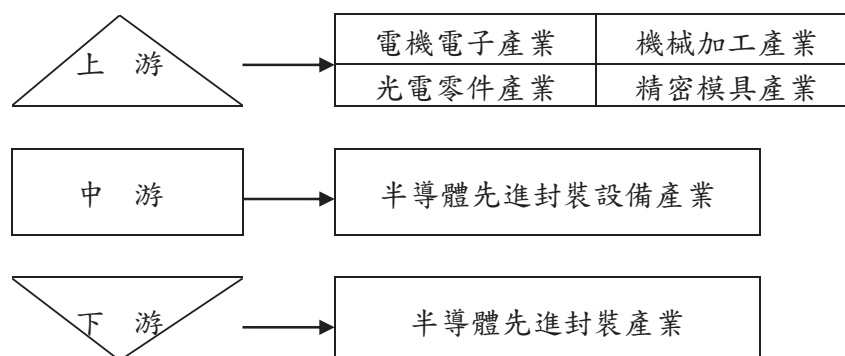
本土 CoWoS 相關設備供應商，系統板測試分類機和 RDL 測試設備，隨 AI GPU 測試時間拉長，運算能力和散熱設計功率(TDP)飆升，系統級測試設備可望受惠從 2024 年起營收大幅成長。相應台灣設備供應商需具備幾個特點：1. 技術發展路徑明確，設備業者在開發階段，可以預測和規畫未來發展趨勢，迅速對準客戶需求；2. 技術種類推陳出新變化快，設備業者要深耕自主研發能力，才得以在新技術中找到商機；3. 台灣半導體設備商，具備設備開發經驗，能夠快速提出一條龍解決方案。然而以上特點非常有利於半導體領域深耕多年的均華精密未來發展。

台灣半導體設備成長趨勢



資料來源：SEMI (2024/12)

2、產業上、中、下游之關聯性



半導體產品主要包含積體電路(IC)、分離式元件/功率元件(Discretes)、感測元件(Sensors)及光學元件(Optoelectronics)等四大類。其中積體電路(IC)產業上游至下游依序可分為 IC 設計、IC 製造、IC 封裝及 IC 測試，其中 IC 製造主要以晶圓代工與記憶體(DRAM、Flash、SRAM、ROM 等)製造為主，而 IC 封裝主要分為導線架封裝(DIP、SOP、QFP 等)、基板封裝(BGA)、軟板封裝(COF、TCP)及先進封裝(Fan-Out、CoWoS)。

3、產品之各種發展趨勢

2025 年全球人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 需求持續攀升，從雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，各個主要應用市場均面臨規格升級趨勢，半導體產業將再度迎來嶄新榮景。

「在 AI 持續推升高階邏輯製程晶片需求，以及高價 HBM 滲透率提升的推動下，預計 2025 年整體半導體市場將成長超過 11.2%；半導體供應鏈包括設計、製造、封測、先進封裝等產業，在上下游橫縱合作之下，將共創新一波成長契機。」

2025 年半導體市場將有下列八大趨勢：

(1) 2025 半導體：AI 驅動的高速成長仍將持續

2025 年半導體市場預計將成長 13.4%。記憶體領域可望成長超過 24%，主要動能來自 AI Accelerator 需要搭配的 HBM3、HBM3e 等高階產品滲透率持續提升，以及新一代 HBM4 預計於 2025 年下半年問世所帶動。非記憶體領域則可望成長 13%，主要受惠於採用先進製程晶片，如 AI 伺服器、高階手機晶片等需求暢旺，另外成熟製程晶片市場也將在消費電子市場回溫激勵下預期有正面表現。

(2) 亞太區 IC 設計市況升溫，2025 年可望再成長 15%

亞太 IC 設計業者產品線豐富多元，應用領域遍布全球，包含 Smartphone AP、TV SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC 等必要晶片。隨著庫存水位大致得到控制、個人裝置需求回暖，以及 AI 運算需求延伸至各類應用都帶動整體需求，預計 2025 年亞太 IC 設計整體市場將持續成長，年成長率達 15%。

(3) 台積電將持續稱霸 Foundry1.0 與 Foundry2.0 領域

在傳統 Foundry1.0 的定義下，台積電市佔從 2023 年的 59%穩健攀升，2024 年達 64%，2025 年更將擴大至 66%，遠超三星、中芯國際、聯電等競爭對手。而在 Foundry2.0 定義中（包括晶圓代工、非記憶體 IDM 製造、封測、光罩製作），2023

年台積電市佔為 28%，但在 AI 驅動先進製程需求大幅提升的態勢下，市佔在 2024、2025 年快速攀升，展現在新舊產業結構下的全方位競爭優勢。

(4) 先進製程需求強勁，晶圓代工廠擴產加速

先進製程（20nm 以下）在 AI 需求推動下加速擴產。台積電不僅在台灣廠區持續打造 2nm 及 3nm，美國廠區 4/5nm 也即將量產。三星則憑藉著搶先進入 GAA 世代的經驗，在韓國華城（Hwaseong）打磨 2nm。而英特爾在新策略規劃下壓注 18A 製程開發，並以吸引更多外部客戶為未來幾年的目標。整體來看，預計晶圓製造 2025 年產能年增 7%，其中先進製程產能將年增 12%，平均產能利用率可望維持 90% 以上高檔，AI 需求驅動引爆的半導體榮景持續發酵。

(5) 成熟製程市況回溫，產能利用率將逾 75%

成熟與主流製程（22nm-500nm）應用範圍廣泛，涵蓋消費性電子、車用、工控等領域。展望 2025 年，預期在消費電子帶動，以及車用與工控領域可望出現零星庫存回補動能下，整體需求將持續回溫。8 吋晶圓廠平均產能利用率從 2024 年的 70% 攀升至 75%，12 吋成熟製程平均產能利用率也將提升至 76% 以上，預期 2025 年晶圓代工產能利用率平均提升 5 個百分點。

(6) 2nm 為 2025 晶圓製造技術關鍵年

2025 年將是 2nm 技術的關鍵年，三大晶圓製造商都將進入 2nm 量產。台積電戮力於新竹及高雄擴廠，預計在下半年穩健邁入量產。三星、英特爾則在戰略調整下，全力聚焦在 2nm 世代，三大廠商將面臨 PPAC（效能、功耗、體積、價格）的嚴峻挑戰，包括晶片效能、功耗表現以及單位面積成本的整體最佳化，屆時各家的良率爬升速度與擴產節奏將成市場關注焦點。

(7) 封測產業生態重整，中國市佔將持續擴張，台灣 AI 封測優勢攀升

地緣政治影響之下，全球封測版圖正在重組。中國在「半導體自主化」政策推動下，晶圓代工成熟製程產能快速成長，下游封測產業也並行擴張，形成了完整的製造生態系統。台廠在此態勢下展現另一面產業優勢，不僅加速在台灣及東南亞布局產能，也深耕 AI 晶片先進封裝技術。2025 年，中國封測市佔將持續上揚，台廠則鞏固在 AI GPU 等高階晶片的封裝優勢。預計 2025 年整體封測產業將成長 9%。

(8) 先進封裝：FOPLP 布局深耕，CoWoS 擴產倍增

半導體晶片功能與效能要求不斷提高，先進封裝技術日益重要。在 FOPLP 方面，2025 年起將快速成長，目前以玻璃 Base 製程為主，應用於 PMIC、RF 等小型晶片，預計技術累積數年後可望進軍封裝面積要求更大的 AI 晶片市場，並導入技術門檻要求更高的玻璃 Base 產品。另外，在 NVIDIA、AMD、AWS、Broadcom 與雲端服務供應商（CSP）等高效能運算客戶需求推動下，台積電 CoWoS 產能持續倍增，目標將從 2024 年的 33 萬片大幅擴充至 2025 年的 66 萬片，年增 100%，而台灣設備供應鏈將在此波擴產潮中獲得更多成長契機。

4、競爭情形

(1)外部競爭環境及總體經營環境

隨著美中科技戰持續升溫，台灣 AI 產業供應鏈面臨新的挑戰與機遇。這些外部壓力促使台灣企業積極調整其全球生產佈局，通過擴大國際合作來強化產業韌性。同時，生成式 AI 技術的發展也進一步提升了台灣在全球供應鏈中的地位，推動企業從傳統晶圓代工向 AI 代工（AI Foundry）轉型，形成一個更具競爭力的產業生態系。

全球半導體產業的未來走向也受到各國政策的深遠影響。美國晶片法案、歐盟晶片法案，及台灣和日本等產業發展計劃，正在重塑全球半導體供應鏈的生態系。儘管客戶對於台廠產能無法再完全集中於台灣，台灣作為全球半導體先進製程與研發紮根的核心重鎮，將在政策支持和技術創新下，繼續扮演關鍵角色。

台灣 AI 產業憑藉其在半導體製造、伺服器生產等領域的優勢，已在全球 AI 產業鏈中確立了重要地位。通過持續創新與轉型升級，台灣不僅能維持其競爭優勢，更有望成為全球 AI 產業發展的重要推手，在技術進步與社會價值之間達致平衡。

如何提高自身外部競爭能力可由幾處著手:1. 技術外流與人才流失，台灣應建立嚴格的技术出口管制機制，確保核心技术始終掌握在本土手中。2. 營運成本與市場份額變動，台灣企業應加速技術創新，以提高產品附加價值，降低單純成本競爭的風險。3. 多元市場與供應鏈分散化，可積極尋求與日本、韓國、歐洲等國家建立技術合作與市場聯盟，從而分散風險、擴大國際影響力。

(2)法規環境

誠信為本公司核心文化，故經營向以遵行法律規範、誠信守紀為基本前提。除隨時收集外部法規變動資訊提供管理階層參考，並即時建置、檢討、更新或調整內部管理、運作規章制度，以積極因應各類法規環境之變化。

(3)總體經營環境

本公司經營以半導體產業為主，其半導體市場為全球消費市場之聯動關係，預計半導體市場在車用電子、智慧手機、CIS、SIP、高速運算與人工智慧 5G 乃至於元宇宙等多重動能驅動之下，加上台灣大廠持續加大投資，新製程發展及量產擴產，是設備投資的引爆點，但隨著 IC 未來將以新穎多變的樣貌出現。設備商面對著不斷衍生的新機會，同時也面臨不進步將被淘汰的嚴厲挑戰，持續性的研發求變成為永續生存成長的必然。

受惠於通膨降溫，加上整體就業市場穩定，消費力回升，以及產業面的庫存調整大致完成，再加上 AI 帶動對半導體需求增加，「全年發展持樂觀看待。」

未來值得注意的兩大關鍵議題。首先，AI 發展將從雲端走向終端，生成式 AI 風潮將逐步落地至更多終端裝置的應用，除了帶動新一波 AI 伺服器的需求，AI PC 與 AI 手機也將成為終端消費市場成長的新動力，亦為生成式 AI 普及的關鍵應用。

第二，除了半導體製程持續微縮，高階封裝技術也是未來大廠的布局方向。基於成本、效能和微型化等考量因素，業界發展出多種封裝技術，除了 2.5D、3D 等

IC 封裝技術外，也驅動扇外型封裝延伸至面板級載體。臺灣半導體產業應把握這兩大機會，提前布局相關技術與產品，持續鞏固護國群山的優勢。

均華發展自有核心技術，成功置入供應鏈，由志聖、均豪、均華等大廠組成的「G2C 聯盟」，近年受惠台積電加速擴大 CoWoS 產能下，在先進封裝領域大有斬獲，半導體營收快速拉升，帶動 2024 年業績顯著成長。均華布局超過 10 年的先進封裝營收佔半導體營收的 60~90%，並透過擴大與台積電及全球前十大 OSAT（半導體封裝測試）廠的合作密度，進一步擴展其在半導體市場的全面布局。未來均華將配合主要客戶持續發展高階製程設備，擴大核心技術及產業應用領域，以最貼近客戶的快速應變，維持長期夥伴合作關係，充分掌握產業脈動、運用資源、創造獲利，為客戶、股東及員工創造最大的價值及多贏模式。

（三）技術及研發概況

1、最近年度及截至年報刊印日止之研發費用

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	114 年度(預計)
研發費用	151,127	222,001
占營業淨額之比例	6.19%	不適用

2、本集團最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研發成果代表
113 年度	1. Wafer & Reel to Wafer & Reel Inspection Sorter (晶圓與捲帶至晶圓與捲帶多功能檢查挑檢機)
	2. Wafer PBI System (晶圓黏晶檢查機)
	3. Wafer Sorter (晶圓多型式拆併機)
	4. Wafer to Tray Cassette Sorter (晶圓到晶粒盤盒挑揀機)
	5. High Throughput and High Accuracy Fully Automatic Fan-Out Die Bonder (高產出扇型封裝高精度大尺寸晶粒黏晶機)
	6. High Throughput and High Accuracy Fully Automatic Flip Chip Die Bonder (高產出高精度覆晶黏晶機)
	7. IGBT LEADFRAME AUTO STAMPING System (IGBT 框架自動裁切設備)
	8. Larger Panel Roate Tester (大轉盤四分度硬板電性測試設備)

（四）長、短期業務發展計劃

1、短期計畫

- (1)鎖定先進封裝發展趨勢，持續與一線大廠配合發展國產化設備。
- (2)以精密取放之核心技術，強化發展半導體主製程設備，佈局先進封裝與記憶體應用以及測試應用領域等新市場。
- (3)整合精密取放與視覺處理技術，發展高附加價值之應用，掌握智慧型手機和人工智慧零件生產專用製程設備。

2、長期計畫

基於核心技術，聚焦主製程設備的發展，建立公司長期成長的發展模式。包括

- (1)以核心技術與一線大廠合作，配合其新製程之需求，提供更完整的製程設備。
- (2)統合 G2C 資源，擴增半導體產業市場的主力產品，研發技術互補，提高總體生產能量，以因應大廠的需求，提昇總體營運績效。
- (3)調整產能佈局，加強台灣研發能量以及大陸廠成本控管，以因應市場需求，並開拓海外新市場。
- (4)發展先進封裝關鍵主製程設備，擴大長期發展潛力。
- (5)應用核心技術，切入電動車、元宇宙、AI、機器人等新市場。
- (6)結合協力廠商，強化開發能力，並提高量產能力與能量。

二、市場及產銷概況

（一）市場分析

2024 年國內半導體業產值回歸成長的軌道，且增幅優於全球的水準，主要是由於 2023 年基期偏低，終端應用市場出貨量由負轉正，加上行業庫存調整已告一段落；然而美中科技戰牽動的全球版圖變化仍值得關注，尤其是兩強間的政策攻防恐持續牽動國際供應鏈，台灣半導體業者也需特別留意美國對於中國的各項管制政策，尤其美國商務部特別至盟友等國說明細部內容；此外，台廠於海外投資的進程，甚或是有其他新的投資案，勢必將為 2025 年市場關注的焦點之一。

以半導體封測領域來說，日月光 FOCoS-Bride、台積電 CoWoS 及 Chiplet 等先進封裝技術，可實現處理器、加速器、記憶體模組的高速度、低延遲、高效能的數據訊號傳輸，當中台積電 CoWoS 產能依舊是各家 AI 晶片業者積極爭奪的對象，其 CoWoS 先進封裝客戶來自於 Nvidia、Apple、AMD、Broadcom、Marvel、Xilinx 等，在此情況下，台積電擴產後 2024 年底月產能較原訂倍增達到 3.2 萬片、2025 年底為 4.4 萬片，期望能滿足客戶的需求。

本公司經營以半導體產業為主，其半導體市場為全球消費市場之聯動關係，預計半導體市場在車用電子、智慧手機、SIP、先進封裝、高速運算與人工智慧以及 5G 等多重動能驅動之下，加上台灣及中國大陸持續加大投資，新製程發展及量產擴產，是設備投資的引爆點，但隨著 IC 未來將以新穎多變的樣貌出現。設備商面對著不斷衍生的新機

會，同時也面臨不進步將被淘汰的嚴厲挑戰，持續性的研發求變成為永續生存成長的必然。

1、主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣仟元；%

銷售地區		112 年度		113 年度	
		金額	%	金額	%
內銷(台灣)		709,493	59.73	1,563,591	64.03
外銷	亞洲(中國大陸)	418,206	35.21	764,090	31.29
	其它	60,153	5.06	114,198	4.68
	小計	478,359	40.27	878,288	35.97
合計		1,187,852	100.00	2,441,879	100.00

2、市場佔有率

全世界半導體封裝業主要以亞洲為封裝基地，又以日本、韓國、台灣、東南亞各國及大陸等地區為主。而半導體封裝型態與產品應用面眾多，所因應產生之製程與設備亦有所差異與不相同，以本公司所研發、生產、銷售之半導體製程設備於台灣市場之市占率而言，由於本公司之利基產品主要為協助客戶切合高階 IC 應用及高單價產品，滿足對晶粒等級篩選以及整體封裝品質之要求，而能承接該類訂單之廠商係為少數國內領導大廠，故本公司產品之市占率能透過至客戶端製造現場估算，本公司推估在 IC 晶粒挑檢機方面約有八成，在黏晶機上約有一成，在沖切成型機上約有四成。由於本公司合作對象囊括一線半導體大廠，且受惠於半導體產業資本支出激增與台灣政府扶持國內半導體供應鏈的政策，相信未來市場占有率應能有所提升。

3、市場未來之供需狀況與成長性

2025 年全球半導體產業營收預期將年增 11.2%、達 6979 億美元高峰，主因 AI 應用蓬勃發展，持續帶動 AI/HPC 晶片與記憶體需求，但川普重返執政後的美國貿易與科技政策不確定性，將成為影響產業發展的最大變數，成長幅度將為之變化。

由於 2025 年全球 AI 與高效能運算需求持續攀升，從雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，各個主要應用市場均面臨規格升級趨勢，半導體產業將再度迎來嶄新榮景。而據統計，預期至 2030 全球半導體市場將成長至一兆美元。

2024 年先進封裝約占整體晶片封裝市場的 44%，由於人工智慧、高性能計算(HPC)、汽車和 AIPC 等多種趨勢的推動，其市占率正穩步增加。半導體晶片封裝製造技術中的 3D 堆疊技術是先進封裝的一大亮點，近年，隨著電晶體微縮技術接近瓶頸，摩爾定律進一步延伸也面臨挑戰，包括覆晶、面板級扇出型封裝 (FOPLP)、2.5D 封裝和 3D IC 等異質整合封裝技術成為台廠持續深耕的領域。根據研調機構 Yole Group 預估，2025 年先進封裝市場占比將正式超過傳統封裝，達 51.03%，顯見先進封裝在半導體產業中的重要性持續提升，且成長相當強勁。

也因為 3D 堆疊技術能為邊緣運算提供強大支持力量，使得終端設備能夠即時回應大量數據處理需求。此外，3D 堆疊的封裝技術還為晶片的異質整合鋪平了道路，能夠將不同製程和功能的晶片整合在一起，例如將 AI 處理器、記憶體和感測器等結合，進一步推動生成式 AI 應用的多元和深化，未來 5G 相關的基礎建設、醫療設備等高效能應用場景，都將可望受益於這些先進封裝技術的發展。

另一方面，扇外型封裝中的面板級封裝技術（FOPLP）已成為市場關注的焦點，隨著智慧手機、穿戴裝置與未來物聯網設備進一步普及，FOPLP 技術的重要性將與日俱增。

隨 AI 時代來臨，台灣企業快速投入異質整合、矽光子、2.5D、3D 等先進半導體封裝技術。將台灣的半導體產業，由 IC 設計到晶圓代工，再到先進封裝與測試，展現出高度的垂直整合能力，進一步鞏固台灣半導體產業的國際競爭力。

均華在精密取放設備長期耕耘，關鍵核心技術為精密取放（Pick and Place）、精密加工與光電整合及 AOI。晶粒挑揀機（Chip Sorter）在台灣市佔逾八成，已經是各大半導體廠優先使用的領導品牌。均華在過去五年和全球最大晶圓代工業者在先進封裝技術，投入可觀的研發人力，也使得公司在晶片取放的精度上有很好的進展，進而對營收的貢獻也顯著的增加。展望 2025 年，全球最大封裝業者和相關模組廠商為了擴展先進封裝應用、車用電子、人工智慧商機，增加設備的採購，進而帶動先進封裝精密取放和貼合製程設備業務增長。隨著均華在精密取放技術的不斷升級，受惠大客戶持續擴產，在手訂單持續創高，未來展望樂觀。

4、競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 2024 年台灣半導體業市場規模年增率擺脫 2023 年與全球市場呈現死亡交叉的局而轉為黃金交叉

新興科技領域進入快速發展階段，內含的半導體矽含量與價值不斷提升將帶動半導體業供應鏈的商機，特別是 AI 及車用領域，使得全球半導體業重回成長的軌道；甚至 2024 年台灣半導體業市場規模年增率擺脫 2023 年與全球市場呈現死亡交叉的局面而轉為黃金交叉，其中主要是來自於台積電業績的推升動能，也就是晶圓龍頭廠商除了在 3 奈米或強化版/變種製程不斷取得重量級客戶的下單外，2024 年台積電在先進製程布局上積極拉開與競爭對手的差距，進入 2 奈米製程的試產階段，同時公司也將展開 1.4 奈米的研發工作，顯然台積電將繼續以優異的製造技術、超高的製程良率、先進製程藍圖可實現性高等競爭優勢，來獨霸全球先進製程的訂單。

B. 台灣持續大力投資半導體產業，有利於本土設備業發展

在歷經疫情、美中科技戰、俄烏戰爭、以巴衝擊、紅海危機、台海軍事情勢緊張等情況下，各國皆意識到半導體為重要的戰略物資。所幸短期內因台灣供應全球 10 奈米以下、7 奈米以下、3 奈米的比重仍高達 69%、78%、95%，故我國尚可藉由先進製程的競爭優勢佔有全球半導體業的制高點。

不過此段時間實施以來，部分國家面臨到建造或生產成本過高、專業人力不足、補助預算分配不均等問題，使得扶植政策推動進程各有所異，此相對也牽動台積電、Intel、Samsung 等於全球的布局情況。台灣半導體業因上中下游供應鏈完整，且不論是研發或產能、設備及材料調度具備彈性，加上研發人才素質高，且可 24 小時隨時待命，故生產的晶片仍具備高度的性價比，因而儘管客戶對於供應鏈韌性建力的要求使得台廠產能無法再完全集中於台灣，但我國依舊是半導體廠先進製程與研發紮根的重鎮。

台灣由於台積電持續加碼布局而使我國持續呈現穩步向前之態勢，政府方面，2024 年 9 月於行政院會中報告的「五大信賴產業推動方案」，針對發展本土半導體設備及材料，目標 2028 年設備產值翻倍、材料產值增加 3 成，合計新增 1,328 億元產值，實行措施包括材料設備自主化、鼓勵採用國產設備與國際大廠合作研發前瞻技術等。

(2)不利因素及因應對策

A.地緣政治影響半導體產業全球化的發展

因應對策：

(A)調整市場佈局，專注先進封裝市場，並開拓海外新市場。

(B)以核心技術為基底，配合先進封裝產業趨勢，投入主製程設備研發，擴大營收。

B.市場對先進封裝製程的需求積極投入，但製程並不統一，技術上又有門檻，不易以單一機型對應不同客戶的需求

因應對策：

(A)持續與一線大廠研發合作，掌握製程發展趨勢與先機。

(B)發展共用的核心模組，配合模組化設計，發展不同製程所需功能，以不同的選項搭配快速因應不同客戶的需求。

(C)增補合適技術人才，並整合外部資源，快速發展模組技術，以快速配合客戶的需求。

C.供應鏈變化與全球市場的重組

因應對策：

(A)模組化設計加速產品的成熟，彈性快速反應，降低資源的投入需求。

(B)以核心技術為基底，推展系列性產品，以提高研發效能。

(C)適度進行工程與客服人員的增補，並加強人員訓練，使具備多種設備服務的能力，以利彈性調度。

(D)整合 G2C 集團資源，以滿足市場生產量能需求。

D.部份零件供應鏈有斷鏈風險。

因應對策：

(A)調整產能佈局，加強台灣與蘇州產能與工程能量交叉支持比重，未來將迎向多元生產，並開拓海外新市場。

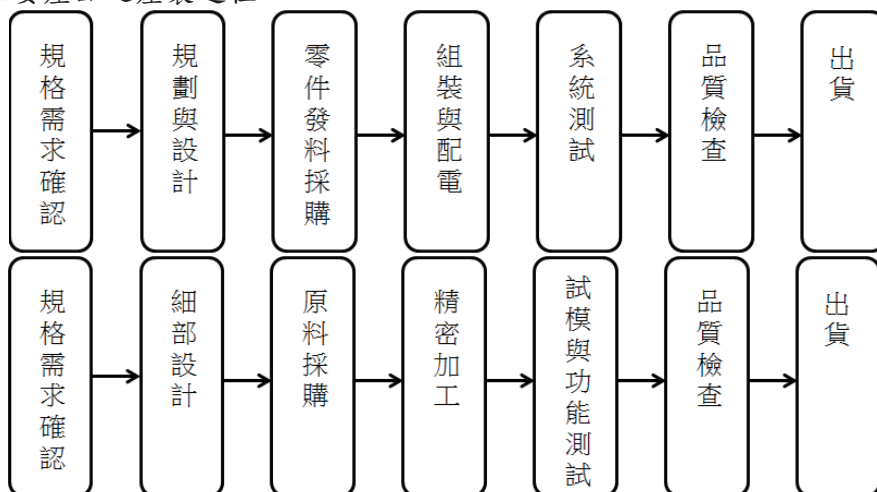
(B)採用多供應商策略，引進海外及台灣第二供應商，分散市場之供應鏈管理模式，以即時遞補缺料供應，以降低缺料風險。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品之用途

產品	用途
晶粒挑檢機	主要針對 8-12 吋晶圓切單後，依具晶圓測試或外觀檢查的結果將晶粒擺放載具中以分級管理或外續製程，載具包括 tray 盤、12 吋晶圓鐵環等各式應用。
黏晶機	主要對 12 吋晶圓切單後，將晶粒以膠材黏合固定於載板上,以利後續打線或其他封裝製程。載板可因封裝製程的不同而異，包括傳統封裝、晶圓級封裝、覆晶封裝及 2.5D/3D 等先進封裝。
沖切彎腳模具與自動設備系列	IC 有腳需要切及彎腳的產品皆需要該設備。近年來研發料管自動排管機提高工作效率，少了人工手動擺放降低人工成本支出。
雷射刻印機系列	由於綠色環保意識抬頭，油墨廢料的汙染環境變成了一大課題，所以雷射刻印便成了封裝廠的首選。雷射無汙染、快速、便捷且多樣化就成了新寵兒。設計了產品自動化上下料、來料二維碼批次判讀、產品視覺定位、產品刻印後清潔、產品刻印後刻印圖形瑕疵品檢查等，一系列的配合工廠無人自動化設備。
視覺檢查機	應用外觀檢查技術配合各種封裝或晶圓的檢查，檢查的項目包括晶粒的瑕疵、封裝的精度，以提高製程品質的掌控。
電測機	針對 PCB 軟硬版光學 CCD 定位精密機構、超高速、多通道、高低電壓等方式,量測高低阻值。

2、主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

2025 年所要面對的議題很多，有全球供應鏈重組，區域性製造中心形成，近岸與友岸外包政策重建，長年所建立的分工合作模式遭遇破壞。全球供應鏈進入重組、大洗牌的時代。

面對供應鏈的大幅變動，短期來看，可從庫存檢討與多元採購著手，補強供應鏈的脆弱環節，來應對短期間緊急的狀況；中長期則藉由強化供應鏈計畫能力、建置跨國生產中心等措施，逐步調整生產策略，以永續經營為目標。多樣化採購策略，將自產零件委外，培養下游廠商的製程能力，將庫存成本移轉到供應商上。

均華集團整體營運 2024 表現為歷年新高，因應先進封裝市場需求，營收呈現強力成長狀態。後續仍會繼續與 G2C 聯盟夥伴協力合作，深耕半導體產業，搶攻先進封裝等商機，以確保未來營運的持續成長。並開拓海外新市場，積極促進技術合作，強化產品設計能力。加大布局、耕耘中長期成長動能，才有機會開創新局、維持優勢。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

1、最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，暨增減變動原因：無。

2、最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，暨增減變動原因

單位：新臺幣仟元；%

	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	1039	295,192	24.85	無	1039	378,670	14.77	無
2	1045	286,927	24.16	無	1045	1,061,108	43.45	無
	其他	605,733	50.99		其他	1,002,101	41.78	
	銷貨淨額	1,187,852	100.00	-	銷貨淨額	2,441,879	100.00	-

變動分析：係因客戶產品需求與資本支出影響。

三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人

年 度		112 年 12 月 31 日	113 年 12 月 31 日	114 年 3 月 31 日
員工人數	間接人員	116	123	123
	直接人員	211	262	258
	合計	327	385	381
平均年歲		42.35	41.84	42.19
平均服務年資		9.60	9.01	9.10
學歷分布比率	博士	1	2	2
	碩士	47	78	77
	大專	198	231	230
	高中	72	69	67
	高中以下	9	5	5

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無此情形。

五、勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1、員工福利措施與實施情形

*薪酬及獎勵

- (1) 每年除了提供年度獎金外，依據公司營運目標、獲利達成率及員工個人績效，發放年終獎金，並按照公司章程提撥員工酬勞。
- (2) 鼓勵員工創新與研發，設立專屬創新研究獎金，以激勵創新能力。
- (3) 對於具有傑出表現的員工，授予激勵獎金，進一步提升工作熱忱與動力。
- (4) 每年根據公司營運目標、獲利達成率及個人績效，提供獎金分配，並依公司章程提撥員工紅利，與員工共享經營成果。

*健康照顧及保險

- (1) 符合法定要求，提供勞工保險、全民健康保險、勞工新制退休金及員工團體保險，包括壽險、意外險、意外醫療險、住院醫療險及癌症醫療險等多元保障。
- (2) 除遵循法定休假規定（如依服務年資計算特別休假）外，公司於固定週休二日的基礎上，每年額外提供三天（24 小時）有薪病假，讓員工在身體不適時可彈性使用。
- (3) 每年為全體員工提供全面的健康檢查，及早發現健康隱患，確保員工身心福祉。
- (4) 積極推動健康促進活動，鼓勵員工培養良好的運動習慣，增強身心健康。

*家庭照顧及補助

- (1) 當同仁因育嬰、重大傷病或家庭變故等需要長期休假時，公司提供留職停薪機制，允許員工在照顧個人與家庭需求後申請復職，實現工作與生活的平衡。
- (2) 提供多項關懷補助，包括生育補助、結婚禮金及喪葬津貼，支持員工應對人生重要時刻。
- (3) 員工眷屬亦享有與員工相同的團體保險福利資格，進一步保障家庭成員的健康與安全。

*職工福利委員會

- (1) 每年依規定提撥福利金，精心規劃多元化的福利措施，包括員工旅遊、生日與年節禮金、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼，以及同仁子女的教育獎助學金，全面關懷員工及其家庭。
- (2) 在特定節日提供暖心的下午茶，增添節日氣氛，傳遞公司對員工的關愛。
- (3) 支持並補助各類員工社團活動，鼓勵員工積極參與，促進工作與生活的平衡，提升身心健康與同事間的連結。

*各式活動

- (1) 每年舉辦年度尾牙聚餐並有摸彩活動，感謝員工一年來的辛勤付出，營造歡樂氛圍。
- (2) 舉辦員工家庭日活動，邀請員工攜家人共度美好時光，藉此表達對員工的感謝，並增強士氣與工作動力，同時促進更高效的團隊合作。
- (3) 在主要節日時策劃各類慶祝活動，讓員工體驗節日的歡樂氛圍，增強企業歸屬感。

*育兒措施

- (1) 設置哺乳室，為育兒員工提供貼心支持，營造友善的工作環境。
- (2) 與特約幼稚園合作，為員工子女提供便利的托育服務，減輕育兒負擔。

*優質工作環境

- (1) 提供免費零食與咖啡，讓員工隨時享用，提升工作愉悅感。
- (2) 不定期舉辦下午茶與部門聚餐，促進同事間的互動與情感交流，營造溫馨的職場氛圍。

2、員工進修及訓練情形

- (1) 新進人員職前訓練：包含瞭解公司概况、發展歷程、產品介紹、管理規章、一般安全衛生教育、作業系統等。
- (2) 本公司每年提供教育訓練補助經費，灌輸員工品質觀念，教導工作技能，培育公司各類人力資源，以提昇員工之技能教育與素養，從而達成品質目標與成效之要求，內容概述如下：
 - A. 內訓部份：各部門提出訓練課程之需求，聘任內部或外部講師於公司內或分區進行訓練。
 - B. 外訓部份：各部門依工作內容需求提出申請，於國內專業訓練機構受訓。
 - C. 本公司 113 年度有關員工之進修及教育訓練統計及支出如下：

教育訓練	內部訓練	外部訓練	總計
訓練梯次	72	74	146
受訓人次	1,537	76	1,613
受訓人時數	2,724	465	3,189
經費支出(元)	\$219,000	\$142,076	\$361,076

- D. 本公司 113 年度員工培訓發展說明如下：

訓練項目	說明
新人訓練	113 年度針對新進同仁安排通識課程訓練共計 65 人次參加，總時數 520 小時。 使其充分了解公司的沿革、企業文化、組織概況、規章制度、工作環境等，並能熟悉本身的權利義務，具備基本工作技能，以期對公司增進認同感與向心力，進而發揮工作績效。

專業訓練	因應各職務所需專業會有不同的培訓課程，總受訓人數為 178 人次，總時數約 1,189 小時。
通識訓練	因應法規要求及提升職場環境的安全，安排了職場的不法侵害處理課程、法律相關的知識及實務應用課程，共 249 人次參加，總時數 352 小時。
軟性課程	安排了家庭關係健康講座系列課程，讓同仁在家庭照顧部分習得更多資訊，共 90 人次參加，共計 90 小時。

3、退休制度與實施情形

本公司依勞工退休金條例之勞退新制，本公司員工每月按總額提撥 6% 退休金，並存入勞保局所設立之員工退休金個人專戶內。員工亦得依個人意願於每月提繳工資 0%~6% 至個人退休金專戶，並由公司按月於員工之工資中代扣其提繳數額。

針對外籍員工採舊制，本公司依照勞動基準法之規定對聘僱外籍員工定有退休辦法，依該辦法規定，退休金之支付係按服務年資及退休時前六個月之平均工資計算，本公司每月依規定提撥退休準備金，交由勞工退休準備金監督委員會管理，並以該委員會名義存入臺灣銀行專戶，並依國際會計準則第 19 號公報之規定，委請精算師對於勞工退休準備金進行評估計算，並提出精算評估報告。

本公司員工有下列情形之一者，得自請退休：

1. 本公司服務年資或併計子公司服務年資達十五年以上且年滿五十五歲者。
2. 本公司服務年資或併計子公司服務年資達二十五年以上者。
3. 本公司服務年資或併計子公司服務年資達十年以上且年滿六十歲者。

勞工退休金條例個人帳戶請領：

1. 請領條件，員工年滿六十歲。
2. 工作年資滿十五年以上者，請領月退休金。工作年資未滿十五年者，應請領一次退休金。
3. 工作年資採計，以實際提繳退休金之年資為準。年資中斷者，其前後提繳年資合併計算。

4、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

- (1) 每季召開勞資會議，由勞資雙方代表共同參與，以維持良好溝通管道。
- (2) 設置「員工申訴專用信箱」，員工可提出問題與反應，由專人彙整及回覆。
- (3) 每半年進行一次績效考核時，收集員工的建議與回饋，並根據員工的意見與提出的問題，改善工作流程及做為新增員工福利措施的重要參考依據。
- (4) 每半年進行一次員工大會，向員工說明公司現況，確保資訊透明並促進溝通。
- (5) 本公司已遵守相關勞動法令並尊重國際公認之勞動人權原則，保障員工之合法權益及履行公平無差別待遇之雇用政策，並已制訂適當之管理。
- (6) 本公司未成立工會，且目前未與員工代表組織簽訂任何形式的團體協約。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞動檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內

容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1、資訊安全人人有責

強化員工資訊安全意識與責任之認知，對於各關鍵業務流程及資訊系統，其所儲存、處理、傳遞或揭露之資料作周全保護與防範，以杜絕毀損、失竊、洩漏、竄改、濫用與侵權等事故，保護客戶資料、公司智慧產出、強化資訊安全事件應變能力及達成資訊安全政策衡量指標。

為保護本公司資訊資產，免於遭受內外蓄意或意外之破壞，並確保企業永續經營，制定資訊安全政策，以保全公司重要資訊資產之安全，包含：

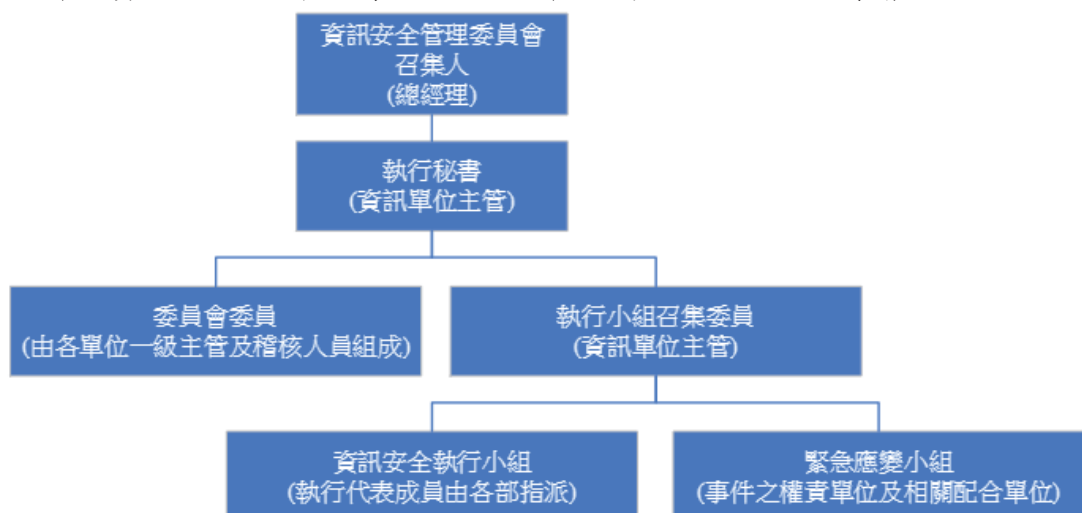
- (1) 機密性 (Confidentiality)：確保只有獲得合法授權的使用者可以存取資訊。
- (2) 正確性 (Integrity)：保障資訊與資訊處理方法的正確與完整。
- (3) 可用性 (Availability)：確保獲得授權的使用者於有需求時能適時存取資訊及相關資產。

透過資訊安全政策之制定，宣示管理階層支持資訊安全之決心，及使相關人員有所依循，並適切合乎公司對於資訊安全之要求，以降低任何資訊安全事件所可能帶來之衝擊，並持續運作及改善，同時保障公司與客戶之權益。

2、資訊安全組織

設立『資訊安全管理委員會』，依職掌執行各項資訊安全治理、規劃、督導及推動執行。每年定期召開管理審查會議，必要時得召開臨時會議，依照評估結果、相關法令、技術及業務等最新發展現況予以適當修訂，以確保符合實際需求。重大決議事項應循公司內部正常公告程序公布，且每年定期向董事會報告資訊安全風險管理情形。

113 年度資訊安全風險管理情形已於 113 年 12 月 19 日報告於董事會。



3、文件系統化管理

為提升資訊安全管理，本公司資訊政策治理及規範，統一由資訊單位提報內部電子簽呈，經各單位一級主管及總經理審核後，由資訊單位透過內部電子文件系統申請，經文管中心流程審理後，發佈全公司文件公告。

4、具體管理方案

- (1)導入次世代防火牆、惡意郵件過濾、網頁過濾防護、作業系統更新、防毒軟體佈署等服務，確保資訊環境運作的安全性及穩定性。
- (2)建置電子郵件安全架構服務，攔阻垃圾郵件及惡意信件散佈，備存並審查外寄郵件避免關鍵資訊外洩。
- (3)佈署使用者端點安控防護服務，管理使用者端設備資源及操作紀錄，避免未經授權的設備存取籍資料輸出。
- (4)避免關鍵核心系統未經授權的存取與修改，確保資料的正確性及完整性，並利用備份及備援機制，維持系統運作的高可用性及可靠性。
- (5)定期辦理核心系統災害復原演練作業，利用本地端及異地端機房進行系統還原作業，確保核心系統可正常運行。
- (6)定期辦理系統弱點掃描、網站弱點掃描等作業，檢測資訊環境中是否存在已知的威脅弱點及安全漏洞，以降低資安風險並提升網站安全強度。
- (7)定期辦理各類資訊安全宣導及教育訓練，並要求新進人員簽訂資訊安全政策同意書，以確保資訊安全政策佈達及全體同仁知悉。
- (8)定期辦理郵件社交工程攻擊演練，提高同仁對於釣魚郵件的警覺心。
- (9)定期檢視及修訂內部作業規範以符合法令法規，並進行內外部稽核作業，檢視各項作業皆能有效被落實執行。
- (10)加入 TWCERT/CC 台灣電腦網路危機處理暨協調中心，透過平台情資共享機制，瞭解及掌握國內外資安威脅與弱點資訊，以利管理及因應。
- (11) 2025 年預計導入 ISO27001 資訊安全認證。

5、資訊安全教育訓練

本公司每年均辦理員工資訊安全教育訓練，經由專題課程說明外部駭客入侵詐騙手法及防範意識，共計 2 場 437 人次。並於每季辦理的新進員工教育訓練中包含基礎資訊安全講習，共計 3 場 71 人次。宣導最新資安觀念給予同仁以減少風險產生，期望提升全員資安意識，隨時隨地保障公司權益。

6、近年投入費用說明



(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
借款合同	玉山銀行	106.06-121.06	長期擔保借款	以台元廠為擔保品
租賃契約	金夏貿易(股)公司	113.01-115.12	土城廠租約	—
租賃契約	啟圓科技(股)公司	113.01-115.12	台元廠租約	—
租賃契約	國堡國際(股)公司	113.09-115.08	台元廠租約	—
租賃契約	平成興業有限公司	113.09-114.08	台元廠租約	—
租賃契約	力錦投資有限公司	112.08-114.09	台元廠租約	—

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

財務狀況比較分析表

單位：新臺幣仟元；%

項目	112 年底	113 年底	差異	
			金額	%
流動資產	2,398,530	2,356,696	(41,834)	(1.74)
非流動資產	958,896	1,507,381	548,485	57.20
資產總額	3,357,426	3,864,077	506,651	15.09
流動負債	1,794,399	1,663,618	(130,781)	(7.29)
非流動負債	262,472	477,852	215,380	82.06
負債總額	2,056,871	2,141,470	84,599	4.11
股本	282,765	282,765	-	-
保留盈餘	335,711	649,591	313,880	93.50
權益總額	1,300,555	1,722,607	422,052	32.45
重要變動項目（前後期變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣壹千萬元以上者）之主要原因及其影響分析說明如下：				
1. 非流動資產增加：係增加透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動所致。				
2. 非流動負債增加：係增加長期借款所致。				
3. 保留盈餘及權益總額增加：係獲利增加所致。				

二、財務績效：

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動

（一）經營結果比較分析表

單位：新臺幣仟元；%

項目	112 年度	113 年度	增（減）金額	變動比例（%）
營業收入淨額	1,187,852	2,441,879	1,254,027	105.57
營業成本	(776,443)	(1,518,370)	741,927	95.55
營業毛利	411,409	923,509	512,100	124.47
營業利益	118,836	441,790	322,954	271.76
營業外收入及支出	(486)	78,545	79,031	162.62
稅前淨利	118,350	520,335	401,985	339.66
所得稅費用	(17,177)	(107,513)	90,336	525.91
本年度淨利	101,173	412,822	311,649	308.04
重要變動項目（前後期變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣壹千萬元以上者）之主要原因及其影響分析說明如下：				
1. 本年度各項目變動皆達 20%以上，係整體營運上揚所致。				

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司預期 114 年度整體銷售業績將穩定成長，預估半導體製程設備及相關精密模具銷售量為 281 套，主係依據總體經濟環境變化、產業景氣及公司未來之發展方向。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新臺幣仟元

項目	112 年度	113 年度	增(減)變動金額
營業活動現金流入	366,898	410,793	43,895
投資活動現金流出	(94,188)	(256,906)	(162,718)
籌資活動現金流入(出)	120,998	(431,335)	(552,333)
增減變動主要原因如下：			
1.營業活動現金流入增加：係因本年度獲利增加。			
2.投資活動現金流出增加：係因本年度取得按攤銷後成本衡量之金融資產增加。			
3.籌資活動現金流出增加：係因本年度買回員工庫藏股及發放現金股利所致。			

(二) 流動性不足之改善計畫：本公司資金充裕，未有流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年 現金流入量(2)	預計全年 現金流出量(3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
628,918	485,558	339,187	775,289	—	—
114 年度現金流量分析：					
1.預計全年現金流入量主要係來自營業相關之活動產生之現金流入。					
2.預計全年現金流出量主要係原物料採購、費用及發放現金股利。					
本公司目前營運資金尚屬充裕，且銀行融資額度仍在，預期未來一年現金流動性佳，並無現金不足額之情形。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：截至年報刊印日止，並無預計重大資本支出。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫

113 年 12 月 31 日；單位：新臺幣仟元

轉投資事業	原始投資金額	政策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫
KMC	393,508	轉投資蘇州均華及轉單中心	因應大陸在半導體業的投資成長，模具與相關封裝設備在中國大陸銷售創造的營收獲利	—
蘇州均華	美金 4,550	中國大陸地區生產及營運據點		—
GMMM	馬幣 500	馬來西亞地區接單、售後服務	其定位為馬來西亞地區接單或售後服務聯繫窗口，並無生產或銷售行為	—
祁昌	53,212	線材及治具測試、印刷電路板測試儀器及系統	市場變化快，設備機種不足	加快新機種開發

轉投資事業	原始投資金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
昆山祁鴻	人民幣 1,000	電路板測試設備、電線電纜及半導體測試及製造	傳統低階產品已被陸製機種搶佔，無競爭力	由低階轉高階，加強高階機種推展銷售

(二) 未來一年投資計畫：截至年報刊印日止，並無預計投資計畫。

六、風險管理分析評估事項：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1、利率變動

本公司之利率風險主要來自銀行存款及借款，112 及 113 年度之利息收入分別為 15,021 仟元及 23,633 仟元，占營業收入淨額比率分別為 1.26%及 0.97%；另利息費用分別為 17,315 仟元及 16,633 仟元，占營業收入淨額比率分別為 1.46%及 0.68%。整體而言，112 及 113 年度之利息收入及利息費用占營業收入淨額比率並不高，故市場利率變動尚未對本公司財務業務狀況造成重大影響。惟未來利率走勢若有較大幅度之波動時，本公司除加強與銀行密切聯繫、瞭解利率走勢，以爭取最優惠的借款利率外，亦將藉由健全之財務規劃，適當運用其它財務工具，以降低利率變動之風險。

2、匯率變動

本公司主要營運據點分別為台灣與中國大陸境內，由於本公司外幣銷貨與採購大部分以美金及人民幣為主，部份外幣應收應付帳款沖抵可降低匯率對本公司損益的影響。112 及 113 年度兌換(損)益分別為(9,201)仟元及 40,950 仟元，占各該年度營業收入比例分別為(0.77)及 1.68%，整體而言匯率變動占營業收入淨額比率不高。本公司仍持續與往來銀行外匯部門保持密切聯繫，主動蒐集市場資訊，以充分掌握匯率可能走勢，並視匯率波動程度及持有外幣部位，由專人評估本公司資金需求，決定換匯時點及換匯金額，藉以減少匯率變動影響損益程度，達到自然避險效果。

3、通貨膨脹

最近一年度及截至年報刊印日止，並未因通貨膨脹而對本公司產生重大影響。惟著眼未來，本公司將持續與客戶及供應商保持密切且良好之互動關係，同時機動調整採購政策與銷售策略，並注意市場價格波動，掌握上游材料的價格趨勢，降低通貨膨脹變動對本公司損益之影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

- 1、本公司訂有「取得或處分資產處理程序」作為本公司執行之依據，本公司並未從事高風險、高槓桿或投機性操作的衍生性商品交易。
- 2、本公司訂有「背書保證作業程序」作為本公司執行之依據，113 年度背書保證之餘額為 60,000 仟元。
- 3、本公司訂有「資金貸與他人作業程序」作為本公司執行之依據，以控管本公司營運風險，113 年度資金貸與之餘額為 50,000 仟元。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司 112 及 113 年度研發費用分別為 119,322 仟元及 151,127 仟元，預計 114 年度研發費用為 221,001 仟元，未來研發之主要方向，係以開拓產品新的運用及多樣性、製程優化及提昇技術增加產品附加價值，並協助客戶解決產品設計、開發、製造

的問題，達到降低成本和提高性能等目的，建立客戶對本公司的信任，取得市場競爭優勢，預計未來投入之研發費用仍將維持一定金額以上，並視營運狀況逐年提升。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司持續密切注意國內外各類重要政策及法律之變動，並配合市場商情之蒐集，調整公司經營策略，以求有效掌握對公司財務業務之影響。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有因國內外重要政策及法律變動對財務業務造成之重大影響。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司致力於創新及研發，以領導產業脈動、追求企業永續經營，中國大陸政府積極發展半導體產業，本公司之蘇州子公司已於中國大陸深耕數十餘年，將充分運用在地化優勢，配合中國大陸地區半導體產業的崛起；且本公司設有專職人員隨時注意相關產業之科技改變情形及產業之變化趨勢，並評估對公司未來發展及對財務業務之影響，作好相關之規劃及採取必要因應措施。

資安風險管理及合規性，確保實施的資安政策及管理程序，符合包括政府法規、半導體產業規範和指標客戶規範，避免因未合規而影響訂單取得或產生的罰款損失。提供培訓和支援，讓所有員工了解資訊安全和規範的重要性、流程和標準程序，定期會議討論資安議題及執行現況，以增強客戶對公司的信任和形象。

最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對財務業務造成之重大影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司承襲三十多年以來，母公司均豪於半導體封裝設備的服務口碑與品牌形象，加上均華成立後全體員工的用心努力，秉持著「團結、拼搏、務實、創新」之企業精神，踏實穩健的經營，善盡企業之社會義務，建立並始終維持良好的企業形象，也獲得客戶的長期信賴與認同。因此，並無因企業形象改變而對企業危機管理有重大影響之情事。另本公司將持續落實執行公司治理，以降低因企業形象改變所產生之企業危機風險機率。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司並未有購併其他公司之計畫，將來若有購併之計畫時，依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理亦將秉持審慎評估之態度，充份考量合併之綜效，以確實保障股東之權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司目前並未有擴充廠房之計畫，未來若有涉及擴充廠房之情事，將審慎評估風險及效益，並依各項作業規定，以確實保障公司利益及股東權益。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1、進貨方面

本公司在市購件及加工件之採購上多保持兩家以上之供應商供貨，以避免受到供貨品質、數量或交期之限制，影響公司營運，整體而言，本公司尚無進貨集中之風險。

2、銷貨方面

本公司係從事半導體封裝製程設備及精密模具之製造銷售業務，主要客戶為兩岸知名半導體之廠商，且無單一客戶大量銷貨集中的現象，尚無銷貨集中之風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無大量股權移轉超過資本額 10%之情形。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，董事會成員及主要經營團隊並無重大改變，因此對本公司營運無重大影響。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

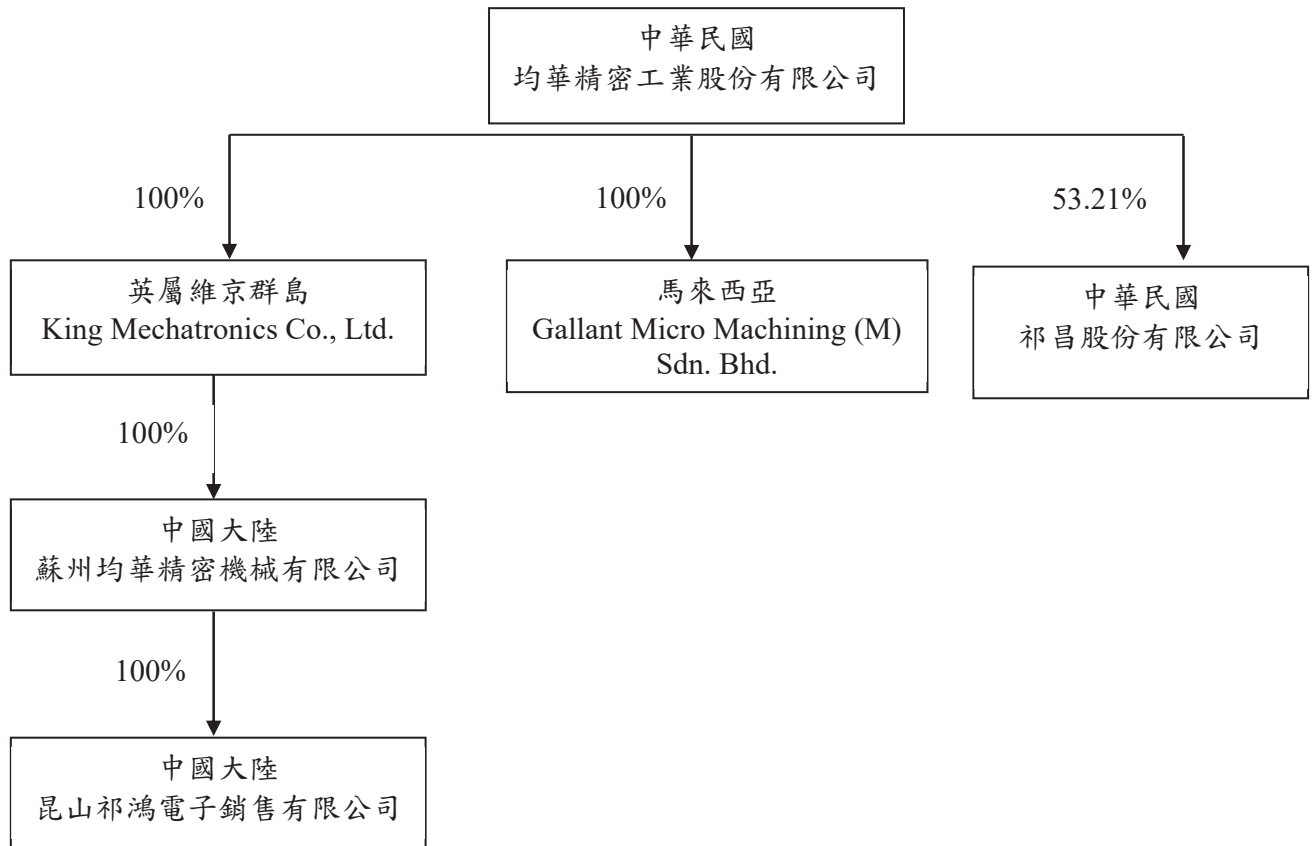
(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業圖



(二) 各關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額 (仟元)	主要營業或生產項目
均豪精密工業股份有限公司	67.12.22	新竹科學工業園區新竹縣創新一路 5-1 號 4 樓	新台幣 1,651,361	顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務
King Mechatronics Co., Ltd.	90.9.24	P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美金 2,781	轉投資蘇州均華精密機械有限公司
Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd.	85.10.8	B303-03-11, Krystal Point, Jalan Sultan Azlan Shah, 11900 Penang, Malaysia	馬幣 500	半導體構裝機器及其相關零件之進出口與買賣業務
蘇州均華精密機械有限公司	92.1.28	中國蘇州市吳中區木瀆鎮金橋開發區寶帶西路 5011 號	美金 4,550	精密模具及其他零件之生產與銷售
祁昌股份有限公司	72.07.21	新北市新店區中正路四維巷 8 弄 9 號 3 樓	新台幣 50,000	線材及治具測試、印刷電路板測試儀器及系統

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額 (仟元)	主要營業或生產項目
昆山祁鴻電子銷售有限公司	98.08.08	中國昆山市玉山鎮恒盛路 1369 號 5 號房	人民幣 1,000	電路板測試設備、 電線電纜及半導體 測試及製造

(三) 各關係企業董事、監察人及總經理資料

113 年 12 月 31 日；單位：千股；%

企業名稱	職 稱 (註 1)	姓名或代表人	持有股份	
			股數 (千股)	持股 比例%
均豪精密工業股份有限公司	董事長	駿朋投資股份有限公司 法人代表：陳政興	500 (註 1)	0.30
	副董事長	志聖工業股份有限公司，法人代表：梁又文	44,759 (註 1)	27.10
	董事	許鴻銘	1	-
	獨立董事	馬堅勇	-	-
	獨立董事	曾國華	-	-
	獨立董事	羅偉	-	-
	獨立董事	陳依梅	-	-
	總經理	陳政興	1,035	0.63
King Mechatronics Co., Ltd.	董事	均華精密工業(股)公司，法人代表：陳榮亮	2,781 (註 1)	100
Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd.	董事 董事 董事 董事	均華精密工業(股)公司，法人代表：許鴻銘 張欽華 劉鑣璘 鄧光榮	500 (註 1)	100
蘇州均華精密機械有限公司	董事長 董事 董事 監察人 總經理	陳榮亮 許鴻銘 林宗諺 徐燕 孫國寧	(註 2)	100
祁昌股份有限公司	董事長	均華精密工業(股)公司 法人代表：許鴻銘	2,660 (註 1)	53.21
	董事	李光英	230	4.61
	董事	奈洛科學儀器有限公司法人代表：李棟樑	1,000 (註 1)	20.00
	董事	均華精密工業(股)公司法人代表：梁又文	-	-
	董事	均華精密工業(股)公司法人代表：曾文進	-	-
昆山祁鴻電子銷售有限公司	監察人	何雅雯	-	-
	董事長 監察人	蘇州均華精密機械有限公司 法人代表：梁明凱 陳書華	(註 2)	100

註 1：為法人股東持股數。

註 2：非為股份有限公司。

(四) 各關係企業營運概況

113 年 12 月 31 日；仟元

企業名稱	資本額	資產 總額	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 淨利(損)	本期 損益	每股 盈餘
均豪精密工業股份有限公司	新台幣 1,651,361	10,519,552	3,759,675	6,759,877	1,854,131	(149,458)	296,749	1.82
King Mechatronics Co.,Ltd.	美金 2,781	1,298,314	285,820	1,012,494	380,537	(3,005)	39,388	-
Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd.	馬幣 500	3,103	27	3,076	53	(50)	109	-
蘇州均華精密機械有限公司	美金 4,550	747,902	158,942	588,960	452,833	44,948	42,997	-
祁昌股份有限公司	新台幣 50,000	153,862	147,479	6,383	63,734	(2,968)	106	-
昆山祁鴻電子銷售有限公司	人民幣 1,000	21,036	14,379	6,657	28,786	499	270	-

(五) 關係企業合併財務報表：請參閱本公司 113 年度合併財務報告暨會計師查核報告。

(六) 關係報告書：

均華精密工業股份有限公司

關係報告書會計師複核報告

財審報字第 24002857 號

均華精密工業股份有限公司 公鑒：

均華精密工業股份有限公司編製民國 113 年度之關係報告書，係依據「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告編製準則」之規定編製，其有關之財務資訊業經本會計師與上開期間之財務報表附註所揭露之相關資訊複核完竣。

依本會計師複核結果，均華精密工業股份有限公司民國 113 年度之關係報告書業依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」規定揭露有關資訊，其財務性資料內容與財務報表一致，無須作重大修正。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳 偉 豪

會計師

吳偉豪

江 采 燕

江采燕



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1080323093 號

核准簽證文號：金管證審字第 1060025097 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 0 日

均華精密工業股份有限公司

113 年度關係報告書

一、從屬公司與控制公司之關係概況

本公司係為均豪精密工業股份有限公司之從屬公司，其資料如下：

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形			控制公司派員	
		持有股數	持股比例	設質股數	擔任董事、監察人或經理人情形	職稱
均豪精密工業股份有限公司	持有具表決權之股份總數超過半數	16,171,750	57.68%	-	董事	簡木發

單位：股；%

二、交易往來情形

本公司與控制公司均豪精密工業股份有限公司之交易往來情形如下：

- (一) 進、銷貨交易情形：進貨新台幣 69,001 仟元；銷貨新台幣 13,338 仟元。
- (二) 應收帳款：新台幣 2,843 仟元。
- (三) 應付帳款：新台幣 15,249 仟元。
- (四) 其他應付款：新台幣 972 仟元。
- (五) 資金融通情形：無。
- (六) 資產租賃情形：無。
- (七) 其他交易：什項費用新台幣 12,560 仟元。

三、背書保證情形：無。

四、其他對財務、業務有重大影響之事項：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒.重大影響事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

均華精密工業股份有限公司



董事長 梁又文

